



2025 アプライド HPC カタログ

HPC SOLUTION CATALOG

CERVO Grasta/HPC Grasta/HPC Deep/CERVO SERVE

HPC製品・AIサーバーで豊かな研究と開発環境を

研究用途からクリエイティブユースまで幅広く対応
AI・科学技術計算・解析・設計・シミュレーション向け

AI学習開発
シミュレーション向けサーバー

CPU演算向けサーバー

シミュレーション/データ解析/
ディープラーニング用途HPC



<https://bto.applied.ne.jp/>

または

アプライドHPC



お電話でのお問い合わせはこちら

TEL:092-481-8050

受付時間

平日 10:00~17:00

CONTENTS

02	CONTENTS掲載/ アプライドHPC製品の生産品質へのこだわり
03	HPC導入インタビュー 東京大学 教授 酒井 幹夫 氏
04	HPC導入インタビュー 東京科学大学 准教授 金子 哲 氏
05	HPC 製品 導入実績一覧
06	タワー型&ラック型対応 高性能HPC専用筐体
07	NVIDIA® RTX™6000 Ada 搭載モデル
08	NVIDIA® H100 Tensor コアGPU搭載モデル
09	AIが物理を学習するフレームワーク NVIDIA Modulus
10	科学技術計算向けワークステーション Grasta/Ryzen™シリーズ
11	CAE/流体解析/映像制作/レンダリング向けモデル Deep Learning Modelシリーズ
12	ディープラーニング向けサーバー

13	ストレージサーバー/エッジサーバー
14	CERVO Grastaモデル紹介
15	HPC Grasta・CERVO Deepモデル紹介
16	HPC Deep・CERVO SERVEモデル紹介
17	HPC SERVE・HPC Edge Serverモデル紹介
18	学術研究用ソフトウェア向けおすすめモデル
19	学術研究用ソフトウェア向けおすすめモデル
20	MSI×APPLIED最先端コンピューターソリューション
21	MSI×APPLIED最先端コンピューターソリューション
22	科学技術計算用ソフトウェアインストール代行サービス/ クラウドモデルパッケージ
23	オンサイトハードウェア保守サービス/サーバラック
24	アプライドHPC 専用サイト

福岡にHPC開発部門 生産工場を設置



ISO9001
ISO14001
認定工場

ISO 9001は企業がお客様に提供する製品・サービスの品質を常に向上させていくことを目指すマネジメントシステムで、ISO14001は環境マネジメントシステムに関する国際規格であります。当初より、大学及び研究機関・企業様の研究内容の多様化、スピード化に合わせ、独自のセル生産によるオーダーメイド製造を行ってまいりましたが、今回の認証取得を機に、当社は、お客様にご提供する製品・サービスの品質を継続的に高めつつ、持続可能な環境状態に対応していくよう今後も努力を続けてまいります。

アプライドHPC製品の生産品質へのこだわり

アプライドは1994年より自社工場にてBTOを製造しています。お客様が安心して長くご利用できるよう、耐久性、信頼性、スペックが、社内品質に合格したものだけを採用し、製品性能をフルに発揮できるように日々の検証を行っています。また、部材供給メーカーや国内正規代理店とも定期的な品質ミーティングを行い、安定した製品のご提供はもちろんのこと、継続的な品質向上に努めています。



国内自社工場生産へのこだわり

ご注文いただいたBTO・HPC製品は、国内の自社工場でのみ製造しています。お客様のさまざまな希望・要望を実現しながら誕生するPCだからこそ、品質にもこだわり続けます。製造基準・マニュアルによる品質の安定化と、経験豊かな製造スタッフによるきめ細かな生産工程で、1台1台丁寧に組み立てます。



自社品質基準による部材品質へのこだわり

オリジナルBTO・HPC製品に使用する部材は、自社品質基準をクリアしたものだけを採用しています。高い性能と耐久性を求められるHPC製品はもちろんのこと、一般事務などで利用されるBTOについても、安心してご利用いただけるように、部材採用選定から製造まで、一貫して品質向上に努めています。



初期不良を未然に防ぐエージング検査

アプライドの国内自社工場生産されるBTO・HPC製品は、標準で12時間のエージング検査を行っています。ある一定の負荷をかけた状態で、長時間の安定した動作を最終確認しています。お客様の目に見えないサービスですが、このテストにより初期不良を未然に防ぐことができます。さらに、ご希望のお客様には、無料で72時間のエージング検査も実施しております。HPC製品や基幹システムにご利用になるPCなど、より安定した動作確認が必要なお客様にも安心してご利用いただけます。



製造現場のこだわり動画

製造現場のこだわり動画をご覧いただけます。





INTERVIEW 01

東京大学 教授 酒井 幹夫 氏

■経歴

2006年東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻博士課程修了、博士(工学)。翌年から同研究科にて助教、2008年に同研究科准教授に就任。2023年3月から原子力国際専攻 教授に就任。現在、世界大学ランキングトップ10のImperial College London、University of Surreyの英国2大学の客員教授(名誉職)にも就任している他、Chemical Engineering Science誌(Elsevier)およびGranular Matter誌(Springer)の編集委員にもアジアを代表する数値シミュレーションの権威として選出され、国際的に粉体シミュレーション分野を牽引している。2023年3月には化学工学において最も権威ある賞のひとつである化学工学会研究賞を受賞。JACM Computational Mechanics Awardをはじめとする数多くの受賞歴がある他、国内外で極めて多くの招待講演の実績もあり、2025年に開催される国際会議The 10th International Conference on Discrete Element Methods (DEM 10)の議長にも選出されている。このように、酒井幹夫教授は、その卓越した研究実績により国際的な注目を集める研究者であり、加えて多くの学生が彼の指導のもとで工学系研究科長賞を受賞していることから優れた教育者でもある。

「最先端粉体シミュレーション」に取り組むようになったきっかけを教えてください。

原子力では、高放射線・高圧・高温の過酷環境が研究対象となるため、実際に実験することが極めて困難です。そのため原子力の分野では、黎明期からコンピュータでのシミュレーション技術に注目が集まってきました。原子力では他の分野より高い安全性が求められるため、シミュレーションには実現象の高い再現性と高効率性が求められます。また、私は原子力国際専攻において粉体を研究していますが、原子燃料は粉体プロセスを経て製造されるため原子力と粉というは決してかけ離れたものではありません。

実際、私たちの身近なところには、粉で構成されたものが数多く存在しています。粉体とは、微小な固体粒子が集積した物質のことなのですが、例えば、医薬品、食品、触媒、鉱物など、さまざまな工業製品の75%くらいが粉の形状を経て作られています。コピー機のトナーも粉で作られており、電池や鉄鋼なども粉体工学がカバーします。牛乳も1ミクロンの単位で粒子(コロイド)と液体が混ざっているように、私たちの身近なところに粉体はあふれています。このように、最先端粉体シミュレーションは、幅広い工学の研究トピックに応用できるツールとも言えます。

では、「最先端粉体シミュレーション」について教えてください。

私の取り組んでいる最先端の粉体シミュレーション技術では、離散要素法 (DEM) と呼ばれる計算手法が広く使われています。粒子同士の相互作用を考慮しながら力学的な計算を行うことで、粉体が係わる物理現象を予測できます。

DEMでは、スプリング、ダッシュポットおよびフリクションスライダーを使って個々の粒子同士の相互作用を計算し、この計算を繰り返すことにより粒子の振る舞いを模擬します。DEM自体は1979年に提案された(古いと思われる?) 計算モデルですが、現在では粉体および混相流のシミュレーションにおいて世界標準となっています。

粉体シミュレーションを実行する際の計算手法には、上記のDEMのほかに、分子動力学法、モンテカルロ法、格子ボルツマン法などがあります。私のグループでは、DEMにいくつかの手法を組み合わせることにより、粉体プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現化に取り組んでいます。

最近、欧米ではIndustry 4.0 (日本ではSociety 5.0) が大きな注目を浴びていますが、実際に今、製造業では第4次産業革命が進行中です。第4次産業革命では、サイバーフィジカルシステムを採用したスマートファクトリーの実現化を目指します。サイバーフ

ィジカルシステムでは、現実空間がサイバー空間に模擬され、両者が同期され、製造工程が効果的に制御されます。サイバーフィジカルシステムのことをデジタルツインとも呼んでいます。

実際の粉体プロセスのサイバーフィジカルシステムを導入して、リアルタイム制御をしようとする、パソコンが必要になるかと思います。標準的な粉体プロセスでは、10億個超の粒子が扱われるのですが、世界屈指の性能のスパコンを使用しても、粉体プロセスをリアルタイムでシミュレーションをするのはかなり難しいのが現実です。

高速に粉体が係わる現象を模擬するという観点から、私たちが研究していることは、粉体プロセスを対象とした縮約モデルの開発です。縮約モデルは、ROM (Reduced Order Model) ※1と呼ばれているのですが、このモデルでは通常のシミュレーションのように方程式をきちんと解くのではなく、データから自由度を減らして計算します。その際、POD (Proper Orthogonal Decomposition) や機械学習をはじめとするデータサイエンスの技術を使用します。このようにして縮約モデルを開発し、シミュレーション結果を教師データ※2として活用して、計算結果を予測することを行います。

産業界ではシミュレーション結果が日々蓄積されていることから、縮約モデルを使えば様々な条件を新たに計算することなく予測することが可能だと思えます。縮約モデルによる計算結果の予測には解決すべき研究課題があるため研究を続けています。

※注釈1…ROM (Reduced Order Model) は、3Dモデルの本質的な挙動を維持したままモデルの次元を落とし(縮退化)、解析時間とデータの容量を大幅に削減する手法です。

※注釈2…教師データとは、機械学習の学習データのうち、問題と正解をセットにしたデータのことです。

現在、力を入れている最先端の計算モデルとは?

では、私のグループで開発した粉体シミュレーション向けの最先端の計算モデルについて説明しましょう。これまでのシミュレーションでは、チューニングや試行錯誤がしばしばなされてきたと思います。私たちのポリシーは、チューニングや試行錯誤をすることなく、実現象の再現性のよいシミュレータを開発することです。

シミュレーションを実行する際、安定領域を超えると計算がストップしてしまうことがあります。不安定にならないようなテクニックを導入することもあると思います。そのテクニックが合理的なものでないとい大きな誤差が生じてしまいます。私のグループでは、方程式を安定的に計算するために陰解法※3というアルゴリズムを導入しています。

これまで流体の数値シミュレーションを実行すると

きには、まずメッシュを生成していました。このメッシュはCADデータに基づいて生成するのですが、新しいシミュレーション体系を計算するたびにメッシュを生成することに時間を費やしていました。しかし私たちが提案した「スカラーフィールド」という手法を使えば、たとえ摩擦などによって壁境界の形状が変化した場合であっても、単にスカラーフィールドの数値を変えただけで、メッシュを生成し直すことなくシミュレーションが実行できます。そのため、スカラーフィールドベースの壁境界を使用すると、デジタルツインにおけるサイバー空間のシミュレーションに柔軟に対応できます。また、これまでメッシュ生成にはノウハウが必要でしたが、スカラーフィールドベースの壁境界でしたら、シミュレーションの経験がない方であっても簡単に壁境界を生成できます。

私たちが世界に先駆けて開発している「粗視化モデル」と呼ばれるスケーリング則モデルについて説明します。粗視化モデルでは、オリジナル粒子群を大きなモデル粒子に代用して計算します。この粗視化モデルを活用すれば、高い実現象の再現性かつ高効率なシミュレーションができます。このようにいくつかの計算モデルをうまく組み合わせることで、粉体プロセスのデジタルツインに要求されるような高速かつ高精度の数値シミュレーションを実行するための研究を続けています。

※注釈3…陰解法とは、数値解法のひとつで、新しいステップの未知数を Δt に足すのに、現ステップの既知数のみを使うのではなく、未知数も含めて連立方程式を解く手法。これに対し陽解法は、現ステップの既知数から、新しいステップの未知数が単純な代数計算で決定される。



弊社から購入いただいたWorkstationはどのように活用しているのですか?

我々のグループでは、CPUを使った並列計算により、粉体シミュレーションの高速化を図っています。計算を高速に実行するためには、高性能なCPUやGPUを使用する必要があります。

これまでアプライドさんから購入させていただいたWorkstationでは、AMD社製のCPU、特にRyzen™ Threadripper™ PRO 5995WXやEPYC 7763あたりが、他のCPUと比べて桁違いの性能であることが分

かっています。GPUについては、データサイエンスのためにNVIDIA A100やNVIDIA RTX™ A6000を使用しています。

私たちは、シミュレーションベースのデジタルツインを構築するときどのような要素モデルが必要なのかという観点から研究を進めています。先ほどからご紹介しているスカラフィールドを使用した壁境界モデルは、デジタルツインにおいて重要な技術であり、壁境界が時々刻々と変化しても柔軟に対応できます。粉体産業におけるDXを推進するために、粉体プロセスにシミュレーションベースのデジタルツインを構築できればと思います。シミュレーションを高効率に実行できるかどうかは、WorkstationのCPUの性能にかかっています。余談ですが、私のグループは、最新のCPUが登場するたびに最上位のCPUを購入して、その性能評価を行っています。

今後の展望について教えてください。

私たちがこれまでに開発してきた計算モデルを用いれば、固体粒子(非球形粒子を含む)、固気・固液二相流および固気液三相流を対象とした複雑現象を模擬することができます。また、これらの計算モデルは常に妥当性確認を行っているため、実現象の再現性のよい結果を得ることができます。そのため、万一、計算結果が実現象と異なる場合、何が原因なのかを容易に同定することができます。

ですから、先に述べたスカラフィールドベースの壁境界モデルや陰解法などの複数の計算モデルを組み

合わせてシミュレーションを実行することで、実現象の再現性がよく高効率に計算結果が得られると思います。これらの手法を組み合わせた最先端粉体シミュレーションを用いることで粉体産業のDXを推し進め、幅広い産業で我々の技術を有効活用していただければと思います。

また、私の研究室は、学生が国内外の学会で表彰されるだけでなく、学科(コース)・専攻で年間ただ一人に贈られる工学部長賞・工学系研究科長賞を極めて多くの学生が受賞しています。今後も、粉体工学の未来を担うことのできる学生や若手研究者の育成に積極的に貢献していきたいと考えています。



INTERVIEW 02 東京科学大学 准教授 金子 哲 氏

■経歴

2012年東京工業大学大学院 理工学研究科化学専攻 修士課程修了。博士課程の2年目だった2014年4月から東京工業大学 大学院理工学研究科 化学専攻の助教に就任。2016年には組織改編により理学院化学系の助教となり、2024年4月から物質理工学院 材料系の准教授。2017年から国立研究開発法人 物質材料研究機構の客員研究員、2018年から国立研究開発法人 科学技術振興機構さきがけ研究員を兼任するなど、各分野で活躍の場を広げている。これまで「単分子接合構造における表面増強ラマン散乱の信号増強機構に関する研究」で日本分光学会奨励賞、2018年には井上研究奨励賞、2022年には「構造解析に基づく点分子接合の物性制御への挑戦」で東京工業大学 挑戦的研究賞など数々の賞を受けている。

「光増強場を利用した単一分子界面構造の特定と制御」の研究に取り組むようになったきっかけを教えてください。

AIやIoTが目玉を集め、コンピュータで処理すべき情報は膨大化し続けています。さらにソフトウェアの進化によって、ハードウェア上の半導体素子が担う役割は日々大きくなっています。2018年、論理回路を立体的に積層できる3Dパッケージング技術などの登場で、半導体の進化の常識は覆されました。しかし情報処理を行う回路が既存のバイナリーな素子を基軸にした設計のまま進化し続けられるのかについては疑問があります。

そこで私たちは、「電子素子」に着目しました。これまでの研究で、単一分子に素子機能を付与した分子素子は、素子サイズが減少することにより、集積密度が向上することがわかっています。ただ残念ながら、スイッチとしての素子性能は今、利用されているものと比較すると劣っているのが現状です。この分子素子をナノレベルまでサイズを小さくすることができれば、全く違う動きをするようになります。しかし今求められている技術革新の世界では、分子素子をただ小さくするだけでは要求レベルに追いつかないだろうと、さまざまな場で指摘されています。私たちは分子素子が機能を発揮できていない重要な要因の一つとして、金属と分子の接続構造があいまいであることが関係しているのではと考えています。それらをふまえて、私たちは新しい機能を持つ素子を能動的に与えることによって変えていくという研究に取り組むようになったのです。

では、「光増強場を利用した単一分子界面構造の特定と制御」の研究について教えてください。

私たちは振動分光法と電子輸送計測の融合計測により、物性と接続構造とを対応付ける手法を開発しました。その手法を用い、金属-分子間にどのような相互作用が働いた場合、どのように電子が輸送されるのかを研究しています。

そこでポイントとなるのが、光増強場です。金属のナノ構造体では光がレンズの様に集まり、通常よりも強い強度を持った光増強場が形成されます。この増強場を用いることによって、通常では観測できない、分子の情報を得たり、分子の動きを制御したりすることが期待されます。

今までとは異なり、私たちは分子素子という一つの分子に仕事を任せようとしています。分子素子を活用するメリットはサイズが小さいため、それを集積することで計算効率が大幅に向上できるだけでなく、作製プロセスを比較的低コストに抑えることができます。これまでさまざまな機能を発現する分子が合成されました。これらの分子を用いるだけでも、新しい機能が期待されますが、さらに分子と金属との相互作用により新しい性質の発現が期待されます。またさらに研究が発展すれば、分子の持つさまざまな電子状態を活用した、新しい脳型素子として活用できる可能性があります。

私たちのこれまでの技術を否定するというのではなく、ハードウェアの設計において全く別のアプローチをすることで、私たちはスーパーコンピュータや量子コンピュータとは全く異なる新たなものを作り出すことができるかもしれないのです。

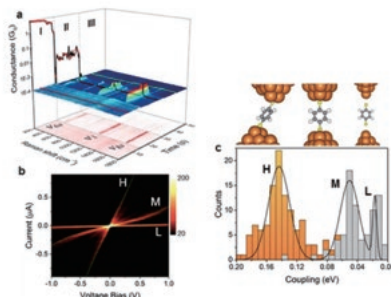


図1 (a)ベンゼン単分子接合の形成および破断過程におけるSERSと伝導度の同時計測結果。3つの領域に分けられ、領域IIはAu単原子接合、領域IIIはBDT単分子接合。(b)ベンゼン単分子接合のI-V特性の分布。(c)I-V特性から求めたカップリング強度の分布関数。オレンジはSERSが観測された単分子接合に対応。東京工業大学ホームページより引用 (分子が金属のどこにどのように吸着しているかの識別に成功-高性能分子デバイス実現に道拓-)。

先生たちが作り出した、表面増強ラマン散乱(SERS)と電流計測を用いた手法について教えてください。

私たちが開発した表面増強ラマン散乱(Surface-enhanced Raman Scattering:SERS)と電流計測を用いた手法では、実際に素子を利用しやすい室温・大気中で、単分子レベルで金属-分子界面構造に関する情報を取得することができます。通常、単分子の振動に由来した信号は非常に微弱で観測が困難ですが、金属ナノ構造体に分子が吸着した場合、SERSと呼ばれる、光増強場と分子と電極間の電子移動の効果によって、信号が増強され、単分子に由来した振動の情報を検出することが可能です。我々は分子を電流計測と振動スペクトルの計測によって分子が電極の間に架橋した瞬間の振動スペクトルの検出に成功し、さらに分子が電極にどのように接続されているかを、調べる方法を構築しました。これらの手法を用いることで、分子による素子を作製した際に、分子の向き等の接続のされ方が、電気の流し方にどのように影響するかを調べることができるようになりました。

これまでの研究をベースに、2023年7月には高感度分子認識法への応用に期待される、「単一の π スタック二量体を識別する手法の開発」を発表しました(東京工業大学 理学院 化学系の本間寛治大学院生、金子哲助教、西野智昭准教授は、物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センターの塚越一仁博士との共同研究)。

この研究では、分子間に働く π 電子を介した相互作用を認識する手法を開発し、相互作用の違いにより生じる π スタック二量体の構造変化を、電流信号と振動スペクトルから識別することに成功しました。本研究手法

HPC導入インタビュー

は室温中で二量体を形成する分子を識別することを可能にしています。今後、基礎科学的な知見を積み重ね、さらに研究を進めることで、化学センサーや病理解明等につながる研究にも展開できる可能性があります。素子としての応用としては、ナノ空間に閉じ込められた空間分解能の高い光を用いる光駆動の記憶素子等への展開なども考えられます。

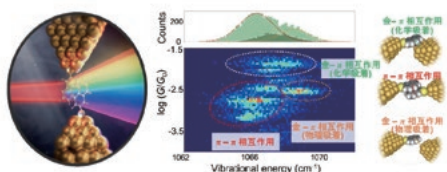


図2. ナフタレン二量体検出の概念図。ナフタレンの振動エネルギー電気伝導度の相関図(中央)と、図中の各領域に対応する相互作用での状態(右)。Gは電気伝導度を表し、1 G0は77.5 μSに相当する。東京工業大学ホームページより引用(単一のπスタック二量体を識別する手法の開発 高感度分子認識法への応用に期待)

この研究の魅力や面白さを教えていただけますか？

この研究の面白さは「意外性」があることでしょうか。設計をベースに実験を行うと、全く予測していたのと異なる現象が起きるケースが多々あります。なぜそうなるのか、という原因を特定していくなかで工夫をしたり、違う発見が得られたり…。それに化学を共通の話題に、学会や研究会で幅広い世代の方とお会いして話をするのができ、交流を通じて自分の世界をぐんと広げることができます。

私自身、研究者としては30代の駆け出しですが、1枚のポスターの前でコーヒー一杯だけで著名な先生との会話がずっと止まらないなんてこともあります。先ほど申し上げた通り、意外な発見があるというのは、この研

究の興味深い点ですが、1つの知識をベースにいろいろな世代の方と研究についてあらゆる角度から話ができるというところがいいですね。分子はさまざまな分野で使われているので、電子材料から生体材料まで幅広い分野の方と出会えるところも魅力です。



弊社から購入いただいたWorkstationはどのように活用しているのですか？

分子素子の研究にはシミュレーションが欠かせません。専用のシミュレーションソフトウェアを動かすためには、高性能のグラフィックボードが搭載されたWorkstationが最適でした。購入前の構想段階からプライドの担当者が丁寧にヒアリングをしてくれたおかげで、理想的なスペックのマシンが手に入りました。もちろん、大学内にはスーパーコンピュータがありますし、使用も可能です。ですが、使用にあたっては制限があり、手続きにも時間がかかります。ですからこのWorkstationは、大学院生たちが研究をするなかで自由にシミュレーションできる環境を持ってほしいという思いで導入を決めました。現在、このマシンは私がシス

テム構築を行っており、近いうちに研究室の学生たちが利用できるように開放する予定です。

そもそもなぜこの分野の研究に興味を持ったのでしょうか？

高校時代から実験などをするうちに、理系の分野には興味がありました。特に、私が化学に興味を持ったのは、私たちの身の回りに起こっている現象がある法則に基づいて起こっていると、その法則を知って組み上げられれば、誰かの役に立てるのでは、と考えたからです。ただ学べば学ぶほど、こうした分野の知識は体系的に学んでいかないと習得が難しいと思うようになりました。理解を深めていった先の世界はもっと深いだろうということで当大学の学部、大学院に進み、追及し続けた結果、今に至ります。

これからこの研究はどういう分野で生かせそうでしょうか？

実際、AIやIoTに欠かせないコンピュータの進化にも貢献できるものですが、この研究は病理診断にも役立つ可能性があります。例えば、身体に異常をきたすような部位がある場合、そこにくっつけられるような分子を仕込んで、そのような部位に流れたときに電気の流し方とスペクトルを計測すれば問題のある箇所を特定することができます。

このように分子は世の中にある幅広い分野で役立てられる研究です。新型コロナウイルス感染症が発生したときには、当初PCR検査に時間を有していました。このような検査にかかる時間を大幅に短縮するための一助となることを目指して、引き続き研究に打ち込んでいきたいです。

サーバー・ワークステーション製品 導入実績一覧

国立・公立・私立大学・専門学校・研究機関 400校以上

琉球大学	宮崎大学	鹿児島大学	第一工科大学	鹿児島県立短期大学	長崎大学	大分大学	日本文理大学
熊本大学	熊本県立大学	九州大学	佐賀大学	福岡教育大学	福岡女子大学	福岡大学	九州工業大学
福岡工業大学	久留米工業大学	久留米大学	福岡歯科大学	九州産業大学	国立有明工業高等専門学校	日本経済大学	北九州市立大学
産業医科大学	九州大学	国立熊本工業高等専門学校	西日本工業大学	山口大学	島根大学	鳥取大学	広島大学
県立広島大学	広島工業大学	広島市立大学	広島修道大学	岡山大学	岡山理科大学	岡山県立大学	愛媛大学
国立新居浜工業高等専門学校	香川大学	徳島大学	高知大学	高知工科大学	高知県立大学	神戸大学	兵庫県立大学
関西学院大学	神戸学院大学	大阪大学	大阪教育大学	大阪公立大学	奈良先端科学大学院大学	大阪工業大学	大阪産業大学
大阪電気通信大学	関西大学	近畿大学	摂南大学	大阪医科大学	奈良女子大学	和歌山大学	京都大学
京都工芸繊維大学	京都教育大学	京都府立大学	京都産業大学	立命館大学	京都先端科学大学	京都女子大学	京都橋大学
同志社大学	龍谷大学	滋賀大学	滋賀県立大学	三重大学	名古屋大学	名古屋工業大学	豊橋技術科学大学
愛知工業大学	中京大学	南山大学	中部大学	名古屋市立大学	国立遺伝学研究所	静岡大学	岐阜大学
自然科学研究機構	核融合科学研究所	国立岐阜工業高等専門学校	信州大学	山梨大学	山梨学院大学	福井大学	金沢大学
北陸先端科学技術大学院大学	北陸大学	金沢工業大学	富山大学	新潟大学	神奈川大学	横浜国立大学	防衛大学校
東京大学	一橋大学	電気通信大学	東京科学大学	東京農工大学	東京都立大学	青山学院大学	駒沢大学
順天堂大学	専修大学	帝京大学	明治大学	東京理科大学	日本大学	学習院大学	慶応義塾大学
上智大学	大東文化大学	中央大学	東海大学	法政大学	立教大学	早稲田大学	お茶の水女子大学
国立情報学研究所	東京外国語大学	工学院大学	芝浦工業大学	東京電機大学	東洋大学	獨協医科大学	拓殖大学
東京都市大学	獨協大学	千葉大学	千葉工業大学	埼玉大学	ものづくり大学	群馬大学	筑波大学
茨城大学	宇都宮大学	自治医科大学	筑波技術大学	国立茨城工業高等専門学校	高エネルギー加速器研究機構	物質材料研究機構	国立環境研究所
産業技術総合研究所	建築研究所	理化学研究所	土木研究所	山形大学	秋田大学	東北大学	宮城大学
東北工業大学	岩手大学	北海道大学	弘前大学	北見工業大学	国立釧路工業高等専門学校	札幌医科大学	国立函館工業高等専門学校

CERVO HPC

セルボ

アプライドオリジナル最先端コンピューターソリューション

高性能HPC専用筐体タワー型&ラック型対応！
日本国内専売モデルのケースを採用！



オプションで、GPU専用冷却外付け
FANユニットを用意。
GPU複数枚搭載の場合も冷却性を
保ち、安定動作を可能にします。



タワー型設置対応。GPU 固定用
PCI ホルダーを標準装備。
簡易水冷ユニットを搭載可能。



2.5/3.5 インチ対応
ホットスワップ。
SSD/HDD ベイを8基搭載可能。



オプションのレールキットで、
サーバーラックへ搭載可能

サーバーやパソコン、その他周辺機器を通常の縦置きで設置するとスペースを大きく占領してしまうため、配線トラブルや、導入・撤去コストの増大・労働生産性の低下につながります。サーバーラックへの収納がおすすめです。



サーバーラックに
収納可能！

① 収納に便利な横置き対応

通常は縦置きが大半のため設置できる場所が限られます。
CERVO HPCは横置きでも通気性がいいため快適です。



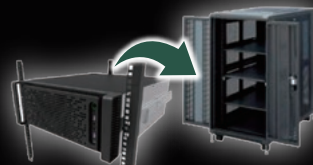
② ラックマウント対応

ラックマウントとは、専用の棚に積み上げるように設置
することです。平積みによって機器をコンパクトに収納でき
て、運搬が容易になります。



③ サーバーラック収納可能

サーバーラックに適したサイズですので、既にラック
をご利用中の方でも、そのまま中に収納することが
できるため場所をとりません。



YouTube JP



オリジナル
動画

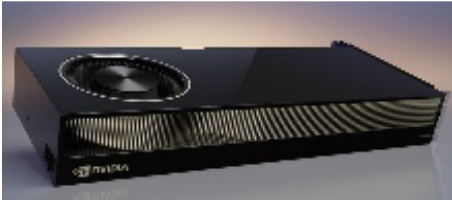
オリジナルケース【SR-630】動画
<https://youtu.be/morV4FFOx58>





NVIDIA RTX™6000 Ada 搭載モデル (2GPU・4GPU・8GPU)

プロフェッショナル向けの究極の性能



NVIDIA RTX™ 6000 Ada 世代は、現代のプロフェッショナルワークフローの課題に対応する優れた機能やパフォーマンスを提供します。NVIDIA Ada Lovelace GPUアーキテクチャをベースに構築された RTX 6000 Ada は、第3世代の RT コア、第4世代の Tensor コア、次世代 CUDA® コアを、48GBのグラフィックスメモリと組み合わせ、かつてないレンダリング、AI、グラフィックス、コンピューティング性能を実現します。

アプライドがお薦める 「NVIDIA® RTX™ 6000 Ada」搭載モデル



CERVO-Grasta Type-ALIS34W-Q-AU017

OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
プロセッサ	Xeon® w7-3455 2.5GHz to 4.6GHz/TB3.0 4.8GHz(Single Core) / - 24コア; 48スレッド
メモリー	256GB(64GBx4) - DDR5-4800; ECC; Registered
ストレージ(標準)	960GB M.2 NVMe-SSD 高耐久仕様
チップセット	インテル W790 チップ・セット非搭載
光学ドライブ	非搭載
ネットワーク	[1ポート] 10ギガ・ビット、[1ポート]IPMI
プロセッサ・クーラー	アクティブ・プロセッサ・ヒートシンク
グラフィック	[1GPU]NVIDIA RTX 6000Ada 48GB GDDR6
電源ユニット	1,200W/100V(1,500W/200V) - 80 Plus Platinum 認証
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

アプライドがお薦める 「NVIDIA® RTX™ 6000 Ada」搭載モデル



CERVO-Grasta Type-ALES5S-Q-AU018

OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
プロセッサ	[2基] インテル® Xeon® Gold 6438Y 2.0GHz to 2.8GHz; TB 4.0GHz (Single Core) - 32コア; 64スレッド
メモリー	512GB(64GBx8) - DDR5-4800; Registered-ECC
ストレージ(標準)	1.92TB M.2 NVMe-SSD 高耐久仕様- PCI Express 4.0(x4)
チップセット	インテル C741 チップ・セット
光学ドライブ	非搭載
ネットワーク	[2ポート] 10ギガビット
プロセッサ・クーラー	アクティブ・プロセッサ・ヒートシンク
グラフィック	[1GPU]NVIDIA RTX 6000Ada 48GB GDDR6
電源ユニット	1,200W/100V(1,500W/200V) - 80 Plus Platinum 認証
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

第4世代 AMD EPYC™ (1基) 搭載 2U AI サーバー (4GPU対応)



HPC Deep Type-AS4UE1S4GP

OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
開発環境	TensorFlow / Pytorch / Chainer (DockerDesktop)
プロセッサ	[1基] AMD EPYC™ 9554 - 3.1GHz to 3.75GHz; TB 3.75GHz (Single Core) - 64コア; 128スレッド
メモリー	768GB(64GBx12) - DDR5-4800; Registered-ECC
ストレージ1	1.92TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0(x4) - 高耐久仕様
ストレージ2	3.84TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0(x4) - 高耐久仕様
光学ドライブ	非搭載
ネットワーク	[2ポート] ギガビット
プロセッサ・クーラー	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
グラフィック	ASPEED AST2600 BMC (D-Sub 15) / [4GPU] NVIDIA® RTX™ 6000 Ada - 48GB; GDDR6 - DisplayPort: 4ポート - PCI Express 4.0(x16) ※ 上記スペックは1GPUあたり
電源ユニット	[2基] 2,600W/200V - 冗長化仕様(1+1) - 80 Plus Titanium 認証
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

第5世代 Xeon® スケーラブル(2基) 搭載 4U AI サーバー (8GPU対応)



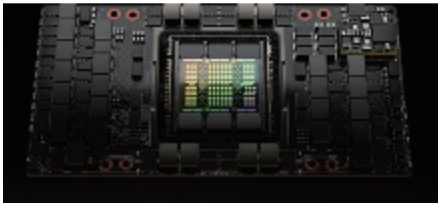
HPC Deep Type-AS4UX2S8GP

OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
開発環境	TensorFlow / Pytorch / Chainer (DockerDesktop)
プロセッサ	[2基] インテル® Xeon® Gold 6530 - 2.1GHz to 2.6GHz; TB 4.0GHz (Single Core) - 32コア; 64スレッド
メモリー	2,048GB(64GBx32) - DDR5-4800; Registered-ECC
ストレージ1	1.92TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0(x4) - 高耐久仕様
ストレージ2	7.68TB SATA3-SSD - 高耐久仕様
光学ドライブ	非搭載
ネットワーク	[2ポート] ギガビット
プロセッサ・クーラー	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
グラフィック	ASPEED AST2600 BMC (D-Sub 15) / [8GPU] NVIDIA® RTX™ 6000 Ada - 48GB; GDDR6 - DisplayPort: 4ポート - PCI Express 4.0(x16) ※ 上記スペックは1GPUあたり
電源ユニット	[4基] 3,000W/200V - 冗長化仕様(2+2) - 80 Plus Titanium 認証
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

お客様のご要望に沿ってあらゆるカスタマイズ構成をご提案可能です。



NVIDIA® H100 Tensor コア GPU搭載モデル



「Hopper」採用 NVIDIA® H100 Tensor Core GPU搭載モデル

最新のGPUアーキテクチャ「Hopper」を採用したNVIDIA® H100 GPUは、生成AIや大規模言語モデル(LLM)といった推論AI、データ分析など大規模計算向けであり、800億個以上のトランジスタで作られた Hopper は、世界最大の言語生成モデルである NVIDIA® の Megatron 530B チャットボット AI 推論で、最大規模のモデルで AI 推論性能を最大 30 倍に引き上げます。

[NVIDIA® H100 GPU] 搭載、Intel Xeon Platinum 搭載の人気モデル

タワー型、ラックマウント型の両対応、お客様のご要望によって更なるカスタマイズが可能です。



WST-WST-XS4410TS3A960TNVM

プリインストールOS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
増設冷却FAN	【標準】前面:9cm高風量FAN×2 背面:9cm高風量FAN×1
CPU	Xeon® Platinum 8558P 2.70 GHz(最大4.00 GHz) 48C/96T 260MB DDR5-5600 TDP=350 W
マザーボード	MBD-X13SEI-F-O/3Y
チップセット	第4.5世代 Xeon® Scalable Socket E1 LGA4677
メインメモリ	512GB (64GB×8) DDR5-4800 1.2V 2RANK Registered ECC DIMM
SSD/HDDプライマリ	3.84TB M.2 NVMe Read 最大5500MB Write 最大2000MB/Sec 高耐久SSD Samsung PM9A3シリーズ
SSD/HDDセカンダリ	3.84TB SSD 6Gb/s SATA R:550MB/s W:530MB/s MTBF:200万時間 高耐久SSD Samsung PM893シリーズ
光学ドライブ	非搭載
内蔵グラフィック	【オンボード】Aspeed AST2600 BMC port(s) IPMI
計算用グラフィックボード	NVIDIA® H100 94GB HBM2e 14592コア PCIe Gen5 x16
サウンド	【オンボード】Realtek ALC888S 7.1 HD Audio
LAN	【オンボード】Dual LAN with 1GbE with Intel® I210
I/O	USB3.2 Gen1×2ポート(前面:2ポート) USB3.2 Gen1×2ポート(背面:2ポート) USB2.0×2ポート(背面:2ポート)
拡張スロット	2 PCIe 5.0×16,3 PCIe 5.0×8,2 PCIe 5.0×8 PCIe5.0 MCIO connector
ストレージ	M.2 Interface: 2 PCIe 5.0×4 Form Factor: 2280/22110 10 SATA3 (6Gbps) port(s) ※要変換ケーブル
メモリスロット	8 DIMM slots Up to 2TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MHz
拡張ドライブベイ	3.5インチシャドウベイ×2(空き2)、2.5インチシャドウベイ×3(空き3)
キーボード/マウス	オリジナル 日本語インテリジェントキーボード(セット)/光学式6ボタンマウス(6段階DPI切替機能)(セット)
電源ユニット	1200W 80PLUS Platinum認証 ATX3.0対応
外形寸法(約)	約(W)175×(D)500×(H)435mm 突起部は除く
保証	【標準】3年間センドバック方式ハードウェア保証



[NVIDIA® H100 GPU] 搭載 AMD EPYC™ 9554 プロセッサ搭載の人気モデル

第4世代 AMD EPYC™ (1基) 搭載 -2UAIサーバー (4GPU対応)



[NVIDIA® H100 GPU] 搭載 Intel® Xeon® Gold2基搭載の人気モデル

4Uラックマウント | 最大8GPU対応



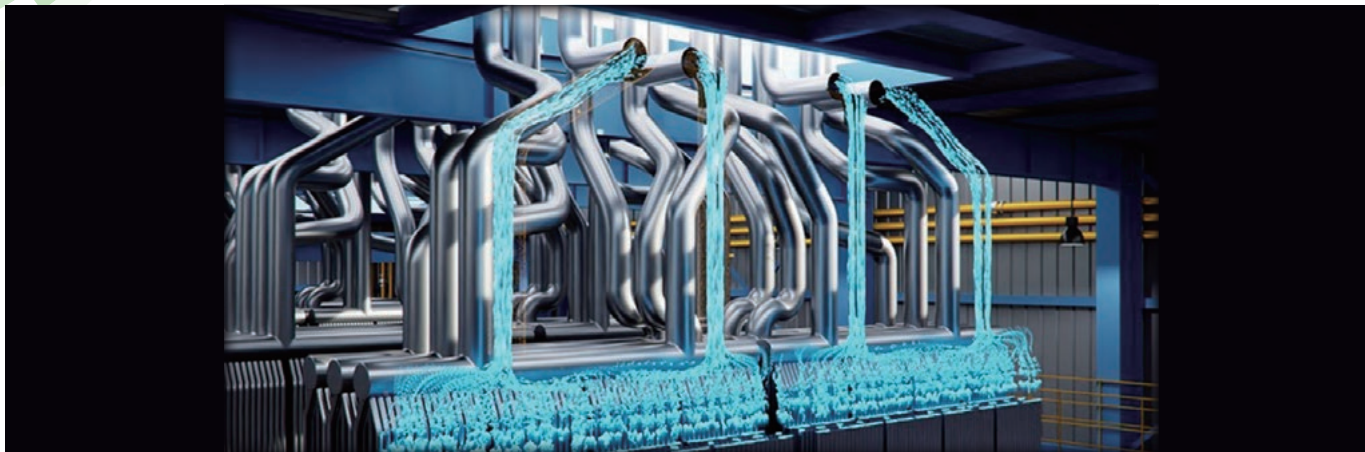
HPC Deep Type-AS4UE1S4GP-AU20

OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
開発環境	TensorFlow / Pytorch / Chainer (DockerDesktop)
プロセッサ	[1基] AMD EPYC™ 9554 - 3.1GHz to 3.75GHz ; TB 3.75GHz (Single Core) - 64コア ; 128スレッド
メモリー	768GB (64GB x12) - DDR5-4800 ; Registered-ECC
ストレージ1	1.92TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0 (×4) - 高耐久仕様
ストレージ2	3.84TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0 (×4) - 高耐久仕様
チップセット	AMD System On チップセット
光学ドライブ	非搭載
ネットワーク	[2ポート] ギガビット
プロセッサ・クーラー	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
グラフィック	[1GPU] NVIDIA® H100 - 94GB ; HBM3e
電源ユニット	[2基] 2,600W/200V - 冗長化仕様 (1+1) - 80 Plus Titanium 認証
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC Deep Type-AS4UX2S8GP-AU019

OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
開発環境	TensorFlow / Pytorch / Chainer (DockerDesktop)
プロセッサ	[2基] インテル® Xeon® Gold 6530 - 2.1GHz to 2.6GHz ; TB 4.0GHz (Single Core) - 32コア ; 64スレッド
メモリー	2,048GB (64GB×32) - DDR5-4800 ; Registered-ECC
ストレージ1	1.92TB U.3 NVMe-SSD- PCI Express 4.0 (×4) - 高耐久仕様
ストレージ2	7.68TB SATA3-SSD -高耐久仕様
チップセット	インテル® C741 チップセット
光学ドライブ	非搭載
ネットワーク	[2ポート] ギガビット
プロセッサ・クーラー	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
グラフィック	[1GPU] NVIDIA® H100 - 94GB ; HBM3e
電源ユニット	[4基] 3,000W/200V - 冗長化仕様 (2+2) - 80 Plus Titanium 認証
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

お客様のご要望に沿ってあらゆるカスタマイズ構成をご提案可能です。



NVIDIA®、AIが物理を学習するフレームワークを開発

NVIDIA® Modulusフレームワークが革新的な物理機械学習MLモデルをトレーニングし、産業用デジタルツイン、気候科学、タンパク質工学などを加速

NVIDIA® はカスタマイズ可能で導入しやすい物理ベースのツールキットを提供する AI フレームワークを発表しました。これは、現代における最も困難な課題への取り組みを加速させるために役立ち、エンジニア、科学者、研究者が、デジタルツインのニューラルネットワーク モデルを構築することが可能になります。

この物理 ML モデルを開発するためのフレームワークである NVIDIA® Modulus は、タンパク質工学や気候科学など、AI の専門知識が不足しているものの、AI と物理駆動のデジタルツイン機能の必要性が急速に高まっている幅広い分野を加速させるために設計されています。

デジタルツインは、創薬のような分子レベルから気候変動のような地球規模までの課題に取り組むための強力なツールとして登場しました。NVIDIA® Modulus は、科学者に複雑で動的なシステムの高精度なデジタル複製を構築するためのフレームワークを提供し、幅広い分野で次世代のブレイクスルーを可能にします。

物理ベースのニューラルネットワーク

Modulus は、物理の基本法則を使用しながら、幅広い分野の複雑なシステムの振る舞いをモデル化するようにニューラルネットワークをトレーニングします。その後、代理モデルは、産業のユースケースから気候科学まで、デジタルツインのさまざまなアプリケーションで使用が可能になります。

多くの AI ベースのアプローチと同様に、Modulus には観測データまたはシミュレーション データの管理に役立つデータ準備モジュールが含まれています。さらに、モデル化するシステムの

ジオメトリと、入力ジオメトリによって表される空間の明示的なパラメーターも考慮されます。Modulus の主要な要素とワークフローは次のとおりです。

- ・ サンプリング プランナー：ユーザーが準ランダムサンプリングや重要度サンプリングなどのアプローチを選択して、トレーニング済みモデルの収束と精度を向上させることを可能にします。
- ・ Python ベースの API：シンボリック支配偏微分方程式を行い、物理ベースのニューラルネットワークを構築します。
- ・ キュレートされたレイヤーとネットワーク アーキテクチャ：物理ベースの問題に効果的であることが証明されています。
- ・ 物理 ML エンジン：上記の入力により、PyTorch と TensorFlow、GPU アクセラレーション用の cuDNN、マルチ GPU および マルチノード スケーリング用の NVIDIA® MagnumIO を使用してモデルをトレーニングします。

NVIDIA® Modulus 向けおすすめモデルはこちら

CERVO Workstation Type-CREATOR-AU003

OS Windows® 11 Pro 64bit	プロセッサ インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ
メモリー 64GB (32GB×2)	ストレージ 1TB M.2 NVMe-SSD (PCIe 4.0 (×4))
チップセット インテル® Z790 チップセット	光学ドライブ 非搭載
ネットワーク [1ポート] 2.5 ギガビット	プロセッサ・クーラー 簡易水冷プロセッサ・クーラー
プロセッサ・クーラー NVIDIA® RTX™ 4000 Ada	グラフィック - 20GB ; GDDR6 - DisplayPort: 4ポート
電源ユニット 1,000W/100V - 80 Plus Gold 認証	保証 3年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC Grasta Type-IS3S-Q-AU21

OS Windows® 11 Pro 64bit	プロセッサ インテル® Xeon® Silver 4314 プロセッサ
メモリー 32GB (8GB×4)	ストレージ 2TB SATA3-HDD 高耐久仕様
光学ドライブ DVDスーパーマルチ	ネットワーク [2ポート] 10ギガビット
プロセッサ・クーラー 4U Active CPU Heat Sink	グラフィック NVIDIA® RTX™ 4000 Ada
ネットワーク - 20GB ; GDDR6	電源ユニット - DisplayPort: 4ポート
グラフィック - PCI Express 4.0 (×16)	保証 900W/100V - 80 Plus Gold 認証
電源ユニット 1,000W/100V - 80 Plus Gold 認証	保証 3年間センドバック方式ハードウェア保証

NVIDIA×APPLIED DeepLearning オンラインセミナーでも紹介されました。

第1部 AIが物理を学習する フレームワーク NVIDIA Modulusのご紹介

講師 柴田 良一氏
国立高等専門学校機構
岐阜工業高等学校
建築学科 構造解析研究室

第2部 今期最も注目されているデータ センターGPU (H100、H200)と NVIDIA最新情報をご紹介

講師 高橋 想氏
エヌビディア合同会社 エンタープライズ事業本部
プロフェッショナル ビジネスソリューション
ビジネスデベロップメントマネージャー



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
**インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載
 ワークステーション**

CERVO Grasta / HPC Grastaシリーズ (Xeon Model)

「CERVO Grasta シリーズ(インテル® Xeon® 搭載)」は、複雑な計算処理を高速で実行するような科学技術計算用途向けのワークステーション(計算機)です。主に CPU(中央演算処理装置)での計算を想定した製品で、インテル® Xeon® プロセッサを搭載しています。

このプロセッサは、高度な計算能力とパワフルなマルチタスク性能を持ち、大量のデータを効率的に処理することが可能です。さらに、Xeon® プロセッサは高い信頼性と耐久性を持つため、長時間の運用にも対応します。

「CERVO Grasta シリーズ(インテル® Xeon® 搭載)」は、科学研究や高度な分析、大規模なシミュレーションなど、最も要求の厳しいタスクに対応するよう設計されています。さらに、最新のメモリとストレージソリューションを備えており、大量のデータを迅速にアクセスし、処理することが可能です。高度な冷却システムも搭載しているため、高いパフォーマンスを維持しながらも、長時間の作業にも耐えることができます。

科学技術計算は下記の3つに大きく分類され、「CERVO Grasta シリーズ(インテル® Xeon® 搭載)」は、そのうち CPU 並列計算と CPU 逐次計算に対応しています。もちろん、カスタマイズで GPU を追加すれば、深層学習・ディープラーニングにもご利用いただけます。



HPC(科学技術計算)並列計算(コア数重視)
AMD EPYC® プロセッサ搭載ワークステーション

CERVO Grasta / HPC Grasta シリーズ(EPYC Model)

「CERVO Grasta シリーズ(AMD EPYC® 搭載)」は、複雑な計算処理を高速で実行するような科学技術計算用途向けのワークステーション(計算機)です。主に CPU(中央演算処理装置)での計算を想定した製品で、AMD EPYC® プロセッサを搭載しています。このプロセッサは、優れたコア数、メモリ帯域幅、I/O容量を持ち、大規模なデータセットと高度な計算タスクの処理に最適です。

AMD EPYC® プロセッサの力強さとスケーラビリティは、科学的な調査、高度なデータ分析、大規模シミュレーション等、最も厳しい要求を持つタスクでも力を発揮します。また、信頼性と耐久性が高く、長時間の運用も支えることができます。

「CERVO Grasta シリーズ(AMD EPYC® 搭載)」は最新のメモリとストレージソリューションを備え、データの迅速なアクセスと処理を可能にします。さらに、高度な冷却システムが搭載されており、持続可能な高パフォーマンスを保証しながらも長時間の作業を支えることができます。



プロセッサは最大 384MB の L3 キャッシュと 8 チャンネルの DDR5 メモリ搭載
**AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO
 プロセッサ搭載ワークステーション**

CERVO Ryzen / HPC Ryzen シリーズ

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WXプロセッサは、前世代の圧倒的なパフォーマンスと優れたプラットフォーム機能をワークステーション市場向けに拡張したものです。最先端の5nm「Zen 4」アーキテクチャをベースに構築されたこの世代は、高い性能が要求されるプロフェッショナル向けアプリケーションや、Revit モデル作成などの複雑なマルチタスク作業において他社製品を圧倒しています。

マルチスレッド作業向けに、Threadripper™ PRO プロセッサは最大96コア、192スレッドを提供し、複雑なシミュレーション、生成デザイン、レンダリング、ソフトウェア編集作業用のワークステーションプロセッサとして最多のコア数を実現し、Chaos V-Rayなどのツールで最大2倍高速なパフォーマンスを発揮します。さらに AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX シリーズ プロセッサは、最大 384MBのL3キャッシュと 8 チャンネルのDDR5メモリーを搭載し、高いメモリー容量と帯域幅を必要とするアプリケーションに対応します。

AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 シリーズ・プロセッサ搭載

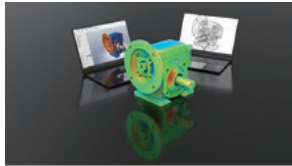
CAE/流体解析/映像制作/ レンダリング向け HPC

ラックマウント対応筐体

CERVO HPC シリーズ

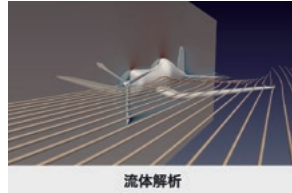


CAE・流体解析・映像制作・レンダリング HPCが必要な理由



CAE (Computer Aided Engineering)

CAEは、コンピュータを利用した工学支援システム。実際に試作や実験をしなくてもコンピュータ上でさまざまなシミュレーションをして、工学的問題を解決できるシステムで、その過程において、高性能なPC (HPC) の使用が求められます。



流体解析

流体解析は、流体(液体や気体)の運動や特性を数値シミュレーションする技術です。流体解析では、解析する対象のサイズや精度によっては、非常に細かいメッシュ(計算領域の分割)が必要です。これにより、計算する要素の数が数百万、時には数十億にもなることがあります。これらを処理するためには、多数のプロセッサを並列に動作させるHPCが必要です。



映像制作・レンダリング

映像制作は、映画、テレビ番組、アニメーション、CM、VRコンテンツなど、視覚的なメディアコンテンツを作成するプロセスを指します。レンダリングは、3DモデルやCGを画像や映像として出力するプロセスです。3D空間でのオブジェクトの配置、ライティング、テクスチャ、カメラアングルなどを設定した後、それを計算して2D画像や映像として生成するのがレンダリングです。映像制作や特にレンダリングは、膨大な計算資源を必要とするため、HPCの使用が重要な要素となります。

AIサーバー向けワークステーション

NVIDIA®GPU ボード搭載 深層学習モデル

Deep Learning Model

CERVO Deep / HPC Deep シリーズ

CERVO Deep シリーズは、深層学習 (Deep Learning) での計算に特化して設計されたHPC製品です。ディープラーニング(深層学習)向けOSとして、Ubuntu 22.04 LTS とWindows® 11 Proのいずれかをご選択いただけます。フレームワーク、ライブラリ(Docker / WSL2)をあらかじめインストールしているので、面倒なセットアップは必要としません。製品が届いた日からすぐにご利用いただけます。

ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)を効率的に学習させる機械学習の手法のひとつです。従来の機械学習手法より高い能力を発揮するとして、研究や商業利用に向けた動きが活発となっており、音声認識や画像認識、画像生成、自然言語処理等、ロボティクス、あらゆる分野で最先端かつ重要なテクノロジーを支えています。ディープラーニングに使用される GPU は、大規模・高度な計算処理に優れ、超人的な速度、精度、規模で学習するトレーニングマシンには欠かせないものです。ビッグデータを実行可能な知識に変える高いパフォーマンスを発揮します。

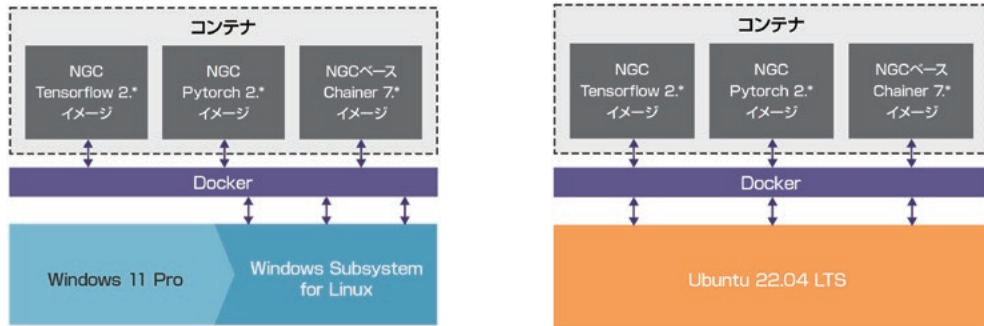
高い性能と耐久性を求められる HPC 製品は、お客様が安心してご利用いただけるように、自社品質基準をクリアした部材のみを採用し、企画から製造までを自社工場(福岡市)で一貫して行っています。

また、部材供給メーカーや国内正規代理店とも定期的な品質ミーティングを行い、安定した製品のご提供はもちろんのこと、継続的な品質向上に努めています。万が一、製品が故障した場合でも、より迅速で確実な修理対応を可能にするために、製造工場に隣接するサービス部門と連携した修理体制を整えています。



深層学習(Deep Learning)に最適化された開発環境

ディープ・ラーニングとは、CUDAを使った深層学習研究、多層構造のニューラルネットワークを用いた機械学習の手法の1つです。インプットした情報が第1層からより深い層に次々と伝達される間に各層で学習が繰り返されて、その過程で特徴量が自動で計算されていくことで、パターンの認識精度が向上するなど、様々な問題の解決に繋がると期待されています。



インストールしたばかりのOSにDeep Learning用のセットアップを1から行うのは非常に時間と手間のかかる作業です。また、フレームワークやライブラリのバージョンの違いによって正常に動作しない場合もあり、可能な限り最新のものを使いつつ整合性の取れた組み合わせでセットアップを行うのは至難の業です。



システム環境復元 USB メディア

USBスティックタイプのリカバリ・ディスクを作成してお届けしますので、万が一のトラブル時も安心です。わずか数回のクリックでパソコンを工場出荷時状態まで戻すことができますので、ソフト的な障害や再インストール作業がご不安な方や面倒な方にお勧めです。Linuxの再インストールが苦手な方には特にお勧めです。

HPC Deep Type-MSAI4UX2S-8GP

4Uラックマウント!最大8GPU(外部強制冷却ファン搭載!H100搭載可能)



システム内部冷却用ファン18基
最大8GPUボード(2 Slot)



U.2 NVMe(PCIe 4.0)2基
SATA3-SSD/
HDD(3.5/2.5インチ)10基



1,000W/100V(2,000/200V)電源
IGLAN 1ポート(IPMI 兼用)
GPU強制冷却ファン



[2基]
第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・
プロセッサ (Sapphire Rapids)



最大4TB / 16チャンネル 構成に対応した
3DS Registered-ECC メモリー

筐体

- タワー筐体(4U)
- 約(W)438 x (D)897 x (H)176 mm

基本ソフト フレームワーク チップセット プロセッサ

- Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
- TensorFlow / Pytorch / Chainer(DockerDesktop)
- インテル® C741 チップ・セット
- [2基] インテル® Xeon® Gold 6530 プロセッサ
- 2.1GHz to 2.6GHz ; TB 4.0GHz(Single Core)
- 32コア ; 64スレッド
- 160MB LLC
- 3 UPI Link
- DDR5-4800
- PCI Express 5,0(80レーン)
- ※上記スペックは1CPUあたり

プロセッサ・クーラー メモリー

- パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
- 1024GB(64GB x16)
- DDR5-4800 ; ECC ; Registered
- 16スロット(16ch)
- 最大4TB(256GB x16 ; 3DS RDIMM)
- ※動作速度は諸条件により異なります

ストレージ

- 1.92TB SATA3-SSD 高耐久仕様(システム用)
- 3.84TB SATA3-SSD 高耐久仕様(データ用)
- D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)
- [4GPU] NVIDIA® RTX™ 6000 Ada 48GB-GDDR6
- DisplayPort x4(1GPUあたり)

グラフィック

- 非搭載
- [2ポート] 10ギガビット(RJ-45)
- 上記有線ネットワーク・ポート兼用
- 非搭載

光学ドライブ

- [冗長化(3+1)] 1,000W/100(2,000W/200V)
- 80 Plus Platinum 認証

ネットワーク(有線)

- 非搭載
- 3年間センドバック方式ハードウェア保証
- レールキット付属

サウンド

電源ユニット

入力装置

保証

ラック・マウント



Windows® Server / Linux Server 搭載
大容量ストレージサーバー(デスクトップ&ラックマウント対応)

Storage Server Model

CERVO SERVE / HPC SERVE シリーズ

高性能HPC専用筐体タワー型&ラック型対応!日本国内専売モデルのケースを採用!

オプションで、GPU専用冷却外付けFANユニットを用意。GPU複数枚搭載の場合も冷却性を保ち、安定動作を可能にします。



タワー型設置対応。
GPU 固定用PCI ホルダーを標準装備。
簡易水冷ユニットを搭載可能。



2.5/3.5 インチ対応ホットスワップ。
SSD/HDD ベイを8基搭載可能。



オプションのレールキットで、
サーバーラックへ搭載可能。

サーバーラックへの収納がおすすめです!

サーバーやパソコン、その他周辺機器を通常の縦置きで設置するとスペースを大きく占領してしまうため、配線トラブルや、導入・撤去コストの増大・労働生産性の低下につながります。

① 収納に便利横置き対応

通常は縦置きが大半のため設置できる場所が限られます。CERVO HPCは横置きでも通気性がいため快適です。



② ラックマウント対応

ラックマウントとは、専用の棚に積み上げるように設置することです。平積みによって機器をコンパクトに収納できて、運搬が容易になります。



③ サーバーラック収納可能

サーバーラックに適したサイズですので、既にラックをご利用の方でも、そのままに収納することができるところをとりません。



サーバーラックに
収納可能!

インテル®Xeon®/ AMD EPYC™ プロセッサ搭載

Edge Server 向け エンタープライズ・プラットフォーム・ソリューション

CERVO Edge Server / HPC Edge Server シリーズ



エッジサーバーは、データ処理をクラウドやデータセンターに送信する前に、ネットワークのエッジ(端末に近い場所)で行うためのサーバーです。これにより、通信の遅延を減らし、リアルタイム性や効率性を高めます。エッジサーバーが活用される主な分野は次の通りです。

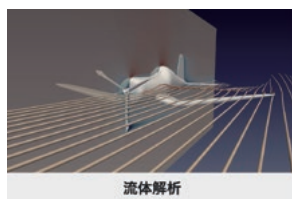
エッジサーバーは、低遅延でのリアルタイム処理とデータの分散処理により、今後ますます多様な分野で重要な役割を果たすことが期待されています。

エッジサーバー・ソリューションの活用



IoT (モノのインターネット)

エッジサーバーは、膨大な IoT デバイスが生成するデータを現地で処理し、必要な情報だけをクラウドに送信することで、ネットワークの負荷を軽減します。例えば、スマートホームやスマートシティ、産業用センサーなどで、リアルタイムのフィードバックや応答を提供するために利用されます。



流体解析


工場の生産ラインやロボット、機械からのデータをリアルタイムで分析し、異常の検知や効率の向上を図るため、エッジサーバーが活躍します。故障予測や生産最適化のための AI アルゴリズムをローカルで実行することも一般的です。











映像制作・レンダリング

自動運転車や交通システムでは、リアルタイムで膨大なデータ処理が必要です。エッジサーバーは車両内や路側に設置され、センサー情報やカメラデータを即座に処理し、交通管理や障害物回避の判断を支援します。









CERVO Grasta

製品イメージ				
製品名	CERVO Grasta Type-ALL55-A800	CERVO Grasta Type-ALE55S	CERVO Grasta Type-MES4SA-Q	CERVO Grasta Type-MES4SA-Q
OS	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応
プロセッサ	第5/4世代インテル® Xeon® スケーラブル	第5/4世代インテル® Xeon® スケーラブル	第5/4世代インテル® Xeon® スケーラブル	第5/4世代インテル® Xeon® スケーラブル
プロセッサ搭載数	2CPU	2CPU	2CPU	1CPU
チップセット	インテル® C741 チップセット	インテル® C741 チップセット	インテル® C741 チップセット	インテル® C741 チップセット
メモリ	64GB-1TB(DDR5)	64GB-1TB(DDR5)	64GB-1TB(DDR5)	64GB-512GB(DDR5)
GPU	NVIDIA® A800 40GB(計算用)	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応
GPUカード搭載数	最大2基	最大2基	最大2基	最大2基
ストレージ	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)
電源ユニット	2000W/200V(1200W/100V)	1500W/200V(1200W/100V)	2000W/200V(1200W/100V)	2000W/200V(1200W/100V)
筐体タイプ	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H435×W175×D630	H435×W175×D630	H438×W176×D650	H438×W176×D650
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証
製品イメージ				
製品名	CERVO Grasta Type-ES3S-Q	CERVO Grasta Type-IS3S-Q	CERVO Grasta Type-ALIS34WC	CERVO Grasta Type-IS34WC-Q
OS	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応	Windows® 11 Pro Windows® 11 Pro for Workstations 各種LinuxOS対応
プロセッサ	第3世代インテル® Xeon® スケーラブル	第3世代インテル® Xeon® スケーラブル	インテル® Xeon® W-34xx プロセッサ	インテル® Xeon® W-34xx プロセッサ
プロセッサ搭載数	2CPU	1CPU	1CPU	1CPU
チップセット	インテル® C621Aチップセット	インテル® C621Aチップセット	インテル® W790チップセット	インテル® W790チップセット
メモリ	64GB-2TB(DDR4)	32GB-1TB(DDR4)	32GB-1TB(DDR5)	32GB-1TB(DDR5)
GPU	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応
GPUカード搭載数	最大2基	最大2基	最大4基	最大3基
ストレージ	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)
電源ユニット	1200W/200V(1000W/100V)	900W/100V	1500W/200V(1200W/100V)	1800W/200V(1200W/100V)
筐体タイプ	タワー型	タワー型	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H424×W193×D525.3	H424×W193×D525.3	H435×W175×D630	H536×W221×D574
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証









HPC Grasta・CERVO Deep

製品イメージ				
製品名	HPC Grasta Type-EPYC-MIS4SA	HPC Grasta Type-SES3WC	HPC Grasta Type-TLS3E	Be-Clia Deep
OS	Ubuntu 22.04 /Ubuntu 24.04 LTS Windows® Server 2025 Standard	Ubuntu 22.04 /Ubuntu 24.04 LTS Windows® Server 2025 Standard	Ubuntu 22.04 /Ubuntu 24.04 LTS Windows® Server 2025 Standard	Ubuntu 22.04 LTS Windows® 11 Pro
プロセッサ	第4世代 AMD EPYC™ プロセッサ	第3世代 AMD EPYC™ プロセッサ	第3世代 AMD EPYC™ プロセッサ	第12/14世代インテル® プロセッサ
プロセッサ搭載数	1CPU	2CPU	1CPU	1CPU
チップセット	AMD System On チップセット	AMD SoC チップセット	AMD SoC チップセット	インテル Q670 チップセット
メモリ	64GB-2TB 2048GB(DDR5)	128GB(DDR4)-4096GB(DDR4)	128GB(DDR4)-2048GB(DDR4)	8GB-128GB(DDR4)
GPU	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応
GPUカード搭載数	最大2基	最大3基	最大3基	最大2基
ストレージ	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)
電源ユニット	2000W/200V(1200W/100V)	[デュアル電源] 1000W/100V×2	2000W/200V(1200W/100V)	1200W/100V
筐体タイプ	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	フル・タワー筐体	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	ミドル・タワー型
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H427×W176×D650	H582×W260×D685	H427×W176×D650	H506×W220×D493
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証
製品イメージ				
製品名	CERVO Deep Type-ALES5S	CERVO Deep Type-ALIS34W	CERVO Deep Type-ALIS24W	CERVO Deep Type-ALIS34WC
OS	Ubuntu 22.04 LTS Windows® 11 Pro	Ubuntu 22.04 LTS Windows® 11 Pro	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS Windows® 11 Pro
プロセッサ	第4/5世代インテル® Xeon® スケラブル プロセッサ	インテル® Xeon® W-34xxプロセッサ	インテル® Xeon® W-24xx プロセッサ	インテル® Xeon® W-34xxプロセッサ
プロセッサ搭載数	2CPU	1CPU	1CPU	1CPU
チップセット	インテル® C741 チップセット	インテル® W790 チップセット	インテル® W790 チップセット	インテル® W790チップセット
メモリ	256GB-4096GB(DDR5)	128GB-2048GB(DDR5)	64GB-2048GB(DDR5)	256GB-4096GB(DDR5)
GPU	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada・A800・H100対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada対応
GPUカード搭載数	最大2基	最大3基	最大3基	最大4基
ストレージ	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)
電源ユニット	1500W/200V(1200W/100V)	1500W/200V(1200W/100V)	1500W/200V(1200W/100V)	2000W/200V(1200W/100V)
筐体タイプ	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H435×W175×D630	H435×W175×D500	H435×W175×D500	H435×W175×D630
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC Deep・CERVO SERVE

製品イメージ				
製品名	HPC Deep Type-LS55	HPC Deep Type-AS2UX2S4GP	HPC Deep Type-T4U8GP6000AD	HPC Deep Type-AS4UE2S8GP
OS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04 LTS
プロセッサ	インテル® Xeon® Gold 5520+プロセッサ	インテル® Xeon® Gold 5520+プロセッサ	Xeon® scalable 4,5世代 プロセッサ	AMD EPYC™ 9754 プロセッサ
プロセッサ搭載数	2CPU	2CPU	2CPU	2CPU
チップセット	インテル® C741 チップ・セット	インテル® C741 チップ・セット	インテル® C741 チップ・セット	AMD System On チップ・セット
メモリ	256GB-1024GB(DDR5)	128GB-1024GB(DDR5)	64GB-512GB(DDR5)	384GB-2304GB(DDR5)
GPU	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada・A800・H100対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada・A800・H100対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada・A800・H100対応	NVIDIA® RTX各モデル NVIDIA® RTX6000ada・A800・H100対応
GPUカード搭載数	最大7基	最大4基	最大8基	最大8基
ストレージ	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)
電源ユニット	[2基]2000W/200V	冗長化(1+1)2600W/200V 電源	冗長化(2+2)3000W/200V 電源	冗長化(2+2)3000W/200V 電源
筐体タイプ	タワー型/ラックマウントタイプ(4U)両対応	ラックマウントタイプ(2U)対応	ラックマウントタイプ(4U)対応	ラックマウントタイプ(4U)対応
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H437×W178×D737	H88.9×W439.5×D800	H174.5×W440×D800	H174.5×W440×D800
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証
製品イメージ				
製品名	CERVO SERVE Type-SM1U2S12H3D	CERVO SERVE Type-SM1U2S8HH3D	CERVO SERVE Type-SM2U2S12H3DA	CERVO SERVE Type-SS4U1S36H3D
OS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS
プロセッサ	Xeon® scalable 3世代プロセッサ	Xeon® scalable 3世代プロセッサ	Xeon® scalable 3世代プロセッサ	Xeon® scalable 3世代プロセッサ
プロセッサ搭載数	2CPU	2CPU	2CPU	1CPU
チップセット	インテル® C621A チップ・セット	インテル® C621A チップ・セット	インテル® C621A チップ・セット	インテル® C621A チップ・セット
メモリ	16GB-1024GB(DDR4)	16GB-1024GB(DDR4)	16GB-1024GB(DDR4)	16GB-512GB(DDR4)
GPU	[オンボード] D-Sub15×1 (Aspeed AST2500 1920×1200)	[オンボード] D-Sub15×1 (Aspeed AST2500 1920×1200)	NVIDIA RTX各モデル NVIDIA RTX6000ada対応	非搭載
GPUカード搭載数	—	—	1基	—
ストレージ	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)	500GB-4TB(SSD)/2TB-24TB(HDD)
電源ユニット	850W/100-240V ユニット数 2基	850W/100-240V ユニット数 2基	2,000W/200V - 1,000/100V ユニット数 2基	1,200W/200V - 1,000/100V ユニット数 2基
筐体タイプ	1Uラックマウント対応(レールキット付属)	1Uラックマウント対応(レールキット付属)	2Uラックマウント対応(レールキット付属)	4Uラックマウント対応(レールキット付属)
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H43×W438.5×D680	H43×W438.5×D680	H87×W438.4×D750.8	H178×W437×D669
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC SERVE・HPC Edge Server

製品イメージ				
製品名	HPC SERVE Type-MSE1URY1S	HPC SERVE Type-MSE1URY1SWC	CERVO SERVE Type-SM2U2S12B-JB1080	CERVO SERVE Type-SM2U2S12B-JB360
OS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	非搭載 オプション(Windows / Linux)	非搭載 オプション(Windows / Linux)
プロセッサ	AMD Ryzen™ 7000 シリーズ・プロセッサ	AMD Ryzen™ 7000 シリーズ・プロセッサ	Xeon® scalable 3世代プロセッサ	Xeon® scalable 3世代プロセッサ
プロセッサ搭載数	1CPU	1CPU	2CPU	2CPU
チップセット	AMD B650 チップセット	インテル® B650 チップセット	インテル® C621A チップ・セット	インテル® C621A チップ・セット
メモリ	16GB-128GB(DDR5)	32GB-128GB(DDR5)	16GB-1024GB(DDR4)	16GB-1024GB(DDR4)
GPU	非搭載	非搭載	非搭載	非搭載
GPUカード搭載数	—	—	—	—
ストレージ	960GB(×2)-7.68TB(×2)(SSD)	960GB(×2)-7.68TB(×2)(SSD)	[RAID1 480GB]480GB×2(SSD)、 18TB×60(HDD)	[RAID1 480GB] 480GB×2(SSD)、 6TB×60(HDD)
電源ユニット	[冗長化(1+1)] 450W/100V	[冗長化(1+1)] 600W/100V	[冗長化] 1000W(1+1)-[冗長化] 1,200W(1+1)/200V	[冗長化] 1000W(1+1)-[冗長化] 1,200W(1+1)/200V
筐体タイプ	1Uラックマウント対応(レールキット付属)	1Uラックマウント対応(レールキット付属)	2U INTEL XeonScalable 2Sサーバー	2U INTEL XeonScalable 2Sサーバー
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H43.5×W438.5×D547.6	H43.5×W438.5×D547.6	H87×W440×D700	H87×W440×D700
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証
製品イメージ				
製品名	HPC Edge Server Type-AEG2UX1SF-R	HPC Edge Server Type-AEG2UX1SGP-F	HPC Edge Server Type-MSEG2UEP1S-F	HPC Edge Server Type-AEG1UX1S-R
OS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS	Windows® Server 2025 Standard Ubuntu 22.04 LTS
プロセッサ	第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル	第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル	AMD EPYC™ 7002 and 7003シリーズ	第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル
プロセッサ搭載数	1CPU	1CPU	1CPU	1CPU
チップセット	インテル® C741 チップセット	インテル® C741 チップセット	System AMD Socket SP3	インテル® C741 チップセット
メモリ	64GB-2048GB(DDR5)	64GB-2048GB(DDR5)	32GB-2048GB(DDR4)	64GB-2048GB(DDR5)
GPU	非搭載	非搭載	非搭載	非搭載
GPUカード搭載数	—	—	—	—
ストレージ	960GB(SSD)	960GB(SSD)	960GB(SSD)	960GB(SSD)
電源ユニット	[冗長化(1+1)] 1,300W/100V	[冗長化(1+1)] 1,300W/100V	[冗長化(1+1)] 1,300W/100V	[冗長化(1+1)] 650W/100V
筐体タイプ	2Uラックマウント対応(レールキット付属)	2Uラックマウント対応(レールキット付属)	2Uラックマウント対応(レールキット付属)	1Uラックマウント対応(レールキット付属)
サイズ(縦幅・横幅・奥行)	H87×W438.5×D430	H87×W438.5×D399	H87×W436×D450	H43.7×W438.5×D430
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

学術研究用ソフトウェア向け おすすめモデル

各種ソフトウェアの特徴、お客様のご用途に合わせ様々な
カスタマイズモデルを提案します。
専任技術者とのオンラインでの打合せも可能

サイエンスの幅広い分野の研究者に向けた計算化学用のソフトウェア

Gaussian

計算科学にお勧めのオリジナル高性能ワークステーション
高性能CPUとGPUの活用によって業務効率を高める最適な構成

汎用量子化学計算「Gaussian」向けモデル

電磁界解析ソフトウェア

Ansys Circuit

Ansys Designer / Ansys Nexxim
快適な動作にお勧めの
オリジナルワークステーション



電磁解析ソフトウェア「Ansys Circuit」向けモデル

分子・動力学計算シミュレーション

Amber

向けおすすめ
モデル

分子・動力学計算「Amber (GPU 計算)」向けモデル

製品イメージ		製品イメージ		製品イメージ	
製品名	HPC Grasta Type-TLS3E-AU003	製品名	Be-Clia Ryzen Type-TR9-202411-01	製品名	HPC Grasta Type-IS24W-G-AU007
OS	Ubuntu 22.04 インストール代行	OS	Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit	OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
プロセッサ	AMD EPYC™ 7543P プロセッサ	プロセッサ	AMD Ryzen™ 9 9950X プロセッサ	プロセッサ	インテル® Xeon® W5-2445 プロセッサ
チップセット	AMD SoC チップセット	チップセット	AMD X670E チップセット	チップセット	インテル® W790 チップセット
プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink	プロセッサ・クーラー	簡易水冷プロセッサ・クーラー	プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink
メモリ	128GB (16GB×8) - DDR4-3200 ; Registered ; ECC	メモリ	128GB (32GB×4) - DDR5-5600 ; Unbuffered ; Non-ECC	メモリ	64GB (16GB×4) - DDR5-4800 (CPUに依存) ; ECC ; Registered
ストレージ	1TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 4.0 (×4)	ストレージ	1TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 4.0 (×4)	ストレージ	960GB M.2 NVMe-SSD 高耐久仕様 4TB SATA-HDD 高耐久仕様
グラフィック	NVIDIA® RTX A1000 8GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8	グラフィック	NVIDIA® A400 - 4GB ; GDDR6 ; Mini DisplayPort: 4ポート - PCI Express 4.0 (×16形状/×8動作)	グラフィック	NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 - 16GB ; GDDR6 - DisplayPort: 3ポート ; HDMI: 1ポート - PCI Express 4.0 (×16)

製品イメージ		製品イメージ		製品イメージ	
製品名	CERVO Grasta Type-ALLS4S-Q-AU004	製品名	HPC Grasta Type-TLS3E-AU002	製品名	HPC Grasta Type-IS24W-Q-AU008
OS	Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit	OS	Ubuntu 22.04 インストール代行	OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
プロセッサ	[2基]インテル® Xeon® Gold 5418Yプロセッサ	プロセッサ	AMD EPYC™ 7543P プロセッサ	プロセッサ	インテル® Xeon® W5-2445 プロセッサ
チップセット	インテル® C741 チップセット	チップセット	AMD SoC チップセット	チップセット	インテル® W790 チップセット
プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink	プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink	プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink
メモリ	512GB (32GB×16) - DDR5-4800 ; Registered-ECC	メモリ	128GB (16GB×8) - DDR4-3200 ; Registered ; ECC	メモリ	64GB (16GB×4) - DDR5-4800 (CPUに依存) ; ECC ; Registered
ストレージ	1.92TB SATA3-SSD 高耐久仕様	ストレージ	1TB M.2 NVMe-SSD - PCI Express 4.0 (×4)	ストレージ	960GB M.2 NVMe-SSD 高耐久仕様 4TB SATA-HDD 高耐久仕様
グラフィック	NVIDIA® RTX 6000Ada 48GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×16	グラフィック	NVIDIA® RTX A1000 8GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8	グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8

掲載の無いソフトウェアにつきましても特徴、お客様のご用途に合わせ専用の仕様書を作成し、提案します。
お気軽にご相談ください。

学術研究用ソフトウェア向け おすすめモデル

FAST. FLEXIBLE. FREE.
GROMACS
の快適な動作にお勧め

MSC 向けソリューション
Academic Software Bundle
Academic software bundle for structures

QUANTUM ESPRESSO
× アプライド オリジナルワークステーション

分子動力計算「GROMACS」向けモデル「構造、熱、衝突、衝撃関連計算」向けモデル第一原理計算「Quantum ESPRESSO」向けモデル

製品イメージ		製品イメージ		製品イメージ	
製品名	CERVO Grasta Type-ALES5S-Q	製品名	CERVO Grasta Type-IS3S-Q-AU005	製品名	Be-Clia Ryzen Type-TR9-AU010
OS	オプション (Windows® /Linux)	OS	Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit	OS	Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit
プロセッサ	[2基] インテル® Xeon® Silver 4514Y プロセッサ	プロセッサ	インテル® Xeon® Silver 4314 プロセッサ	プロセッサ	AMD Ryzen™ 9 7950X3D プロセッサ
チップセット	インテル® C741 チップセット	チップセット	インテル® C621A チップセット	チップセット	AMD X670E チップセット
プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink	プロセッサ・クーラー	4U Active CPU Heat Sink	プロセッサ・クーラー	簡易水冷プロセッサ・クーラー
メモリ	256GB (16GB×16) - DDR5-4800 ; Registered-ECC	メモリ	32GB (8GB×4) - DDR4-2933 ; ECC ; Registered	メモリ	128GB (64GB×4) - DDR5-4800 ; Unbuffered ; Non-ECC
ストレージ	960GB SATA3-SSD 高耐久仕様	ストレージ	2TB SATA3-HDD 高耐久仕様	ストレージ	1TB M.2 NVMe-SSD 2TB SATA3-SSD 高耐久仕様
グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8	グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8	グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8

分子動力計算「GROMACS」向けモデル「構造、熱、衝突、衝撃関連計算」向けモデル第一原理計算「Quantum ESPRESSO」向けモデル

製品イメージ		製品イメージ		製品イメージ	
製品名	HPC Grasta Type-MES4SA-Q-AU013	製品名	CERVO Grasta Type-MES4SA-Q-AU006	製品名	HPC Grasta Type-IS34WC-Q-AU009
OS	Ubuntu 22.04 LTS インストール代行	OS	Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit	OS	Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit
プロセッサ	[2基]インテル® Xeon® Gold 6416H プロセッサ	プロセッサ	[2基]インテル® Xeon® Silver 4416+ プロセッサ	プロセッサ	インテル® Xeon® W7-3445 プロセッサ
チップセット	インテル® C741 チップセット	チップセット	インテル® C741 チップセット	チップセット	インテル® W790 チップセット
プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink	プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink	プロセッサ・クーラー	ACTIVE HEATSINK CPU heatsink
メモリ	256GB (64GB×4) - DDR5-4800 ; ECC ; Registered	メモリ	128GB (16GB×8) - DDR5-4800 ; ECC ; Registered	メモリ	256GB (32GB×8) - DDR5-4800 ; ECC ; Registered
ストレージ	960GB SATA3-SSD 高耐久仕様	ストレージ	960GB SATA3-SSD 高耐久仕様	ストレージ	960GB M.2 NVMe-SSD 高耐久仕様 2TB SATA3-SSD 高耐久仕様
グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8	グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8	グラフィック	NVIDIA® RTX A400 4GB GDDR6 - miniDP×4 - PCI-E4.0×8



HPC製品・AIサーバーで豊かな研究と開発環境を

世界有数の総合コンピューターメーカーmsi社と国内オリジナルコンピューターの製造・販売を手掛けるアプライドとのコラボレーションの製品展開。HPC・サーバー、最先端のコンピューターソリューションをご提供いたします。

- AI学習開発
シミュレーション向けサーバー
- CPU演算向けサーバー
- シミュレーション/データ解析/
ディープラーニング用途HPC

CERVO HPC採用ケースは 唯一無二の拡張性

2スロットのGPUを最大4枚搭載しても 余裕のある空間

これまでのGPUサーバーであれば、大型のグラフィックボードを複数搭載するとケースの大きさに対して限界のスペースになってしまい、電源コネクターの配置や冷却に余裕がない製品が大半でした。そこで、こちらのケースであれば非常にゆとりのある空間を確保することができるため、ハイエンドクラスのスペックを100%引き出す構成が可能になります。

GPUの互換性

NVIDIA RTXシリーズ

- NVIDIA RTX A400-4G
- NVIDIA RTX A1000-8G
- NVIDIA RTX RTX2000 Ada
- NVIDIA RTX4000 SFF Ada
- NVIDIA RTX4000 Ada
- NVIDIA RTX4500 Ada
- NVIDIA RTX5000 Ada
- NVIDIA RTX6000 Ada



※232x160外形規格707-FAN9(F)303L322x1GPUHSE

NVIDIA Geforceシリーズ

- GEFORCE RTX 4080 Super AI 16G BLOWER
- GEFORCE RTX 4070Ti Super AI 16G BLOWER
- GEFORCE RTX 4070 Super AI 12G BLOWER

CERVO HPC採用ケースは 様々な用途に適応

以下の特徴が、あらゆる拡張をサポートします。

- 3Uラックマウントタイプ
- 奥行450mmのコンパクト設計
- 2スロットGPU が最大4枚搭載可能
- PCIe 4.0×16レーン×4スロット
- AMD EPYC 7003 シリーズプロセッサ搭載
- DDR4 DIMM8スロット、3200MT/s、RDIMM/RDIMM-3DS
- 10G LAN×2 標準搭載
- ホットスワップ2.5インチベイ6基搭載 S-ATA対応
- 2000W CRPS 80PLUS PLATINUM 冗長化電源(1+1)
- 438mm(W)×131mm(H)×450mm(D)

CERVO HPCは、これらの用途に最適です。

AI	ディープラーニング
HPC	レンダリング
動画編集	4K/8K 3DCG/モデリング 大規模アセンブリ

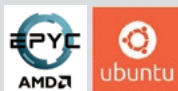


HPC SERVE Type-MSAI3UEP1S-4GP

第3世代 AMD EPYC プロセッサ搭載！
最大4GPU搭載可能！



- OS: Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
- CPU: AMD EPYC 7713 (64コア | 128スレッド)
- メモリ: 128GB (16GB×8) DDR4-3200 ECC Registered
- ストレージ: 960GB SATA3-SSD 高耐久仕様
- グラフィック: 内蔵グラフィック (D-SUB15)
- ネットワーク: [2ポート] 10ギガビット
- 電源ユニット: 1,100W/100V (2,000W/200V) 冗長化仕様(1+1)
- 保証: 3年間センドバック



HPC Deep Type-MSAI3UEP1S-4GP

第3世代 AMD EPYC プロセッサ搭載！
最大4GPU搭載可能！

 NVIDIA NVIDIA® RTX 4500Ada搭載 [1GPU]



- OS: Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
- フレームワーク: TensorFlow/Pytorch/Chainer (DockerDesktop)
- CPU: AMD EPYC 7713 (64コア | 128スレッド)
- メモリ: 256GB (32GB×8) DDR4-3200 ECC Registered
- ストレージ: 1.92TB SATA3-SSD 高耐久仕様
- GPU: NVIDIA® RTX4500Ada 24GB-GDDR6 1基
- ネットワーク: [2ポート] 10ギガビット
- 電源ユニット: 1,100W/100V (2,000W/200V) 冗長化仕様(1+1)
- 保証: 3年間センドバック



CERVO Server Type-MSAITEP1S-630



第3世代 AMD EPYC プロセッサ搭載!

- OS:Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
- CPU:AMD EPYC 7713 (64コア|128スレッド)
- メモリ:128GB(16GB×8)DDR4-3200 ECC DIMM
- ストレージ:960GB SATA3-SSD エンタープライズSSD
- グラフィック:内蔵グラフィック(D-SUB15)
- ネットワーク:[2ポート] 10ギガビット
- 電源ユニット:1000W 80PLUS Platinum
- 保証:3年間センドバック



タワー型設置対応.GPU固定用PCIホルダーを標準装備。

2.5/3.5 インチ対応ホットスワップ.SSD/HDDベイを8基搭載可能。

オプションのレールキットで、サーバーラックへ搭載可能。

オプションで、GPU専用冷却外付けFANユニットを用意。GPU複数枚搭載の場合も冷却性を保ち、安定動作を可能にします。



サーバーラックへの収納がおすすめです!

サーバーやパソコン、その他周辺機器を通常の縦置きで設置するとスペースを大きく占領してしまうため、配線トラブルや、導入・撤去コストの増大・労働生産性の低下につながります。

①

収納に便利横置き対応

通常は縦置きが大半のため設置できる場所が限られます。CERVO HPCは横置きでも通気性がいいため快適です。



②

ラックマウント対応

ラックマウントとは、専用の棚に積み上げるように設置することです。平積みによって機器をコンパクトに収納できて、運搬が容易になります。



③

サーバーラック収納可能

サーバーラックに適したサイズですので、既にラックをご利用中の方でも、そのまま中に収納することができるため場所をとりません。



サーバーラックに収納可能!

HPC Deep Type-MSAI4UEP 1S-4GP

最大4GPU搭載可能 4Uラックマウント・サーバー

NVIDIA NVIDIA® RTX 4500Ada搭載 [2GPU]



- OS:Ubuntu 22.04 LTS インストール代行
- CPU:AMD EPYC 9354 (32コア|64スレッド)
- メモリ:192GB(16GB×12)DDR4-3200 ECC Registered
- ストレージ:960GB U.3 NVMe-SSD 高耐久仕様
- GPU:NVIDIA® RTX 4500 Ada 24GB-GDDR6 2基
- ネットワーク:[1ポート]ギガビット
- 電源ユニット:3000W 80 PLUS Platinum 認証
冗長化電源(1+1)1200W (100V AC input)2800W (200V AC input)
- 保証:3年間センドバック



HPC SERVE Type-MSE1URY1SWC

AMD Ryzen9 7000シリーズプロセッサ搭載!



- OS:オプション
- CPU:AMD Ryzen9 7950X3D (16コア|32スレッド)
- メモリ:32GB (16GB×2)DDR5-5600 ECC ; Unbuffered
- ストレージ:[RAID1] 960GB(960GB×2) SATA3-SSD 高耐久仕様
- グラフィック:[1ポート]D-Sub15
- ネットワーク:[2ポート]10ギガビット (RJ-45)
- 電源ユニット:600W 冗長化(1+1) 80 PLUS Platinum
- 保証:3年間センドバック



アプライド 科学技術計算用ソフトウェア インストール代行サービス

OS やソフトウェアのインストール代行から、 深層学習・ Docker などの環境も構築

アプライドではHPC製品(ハイ・パフォーマンス・コンピューティング)の製造だけでなく、科学技術計算用ソフトウェアのインストール代行も承っております。弊社製のHPC製品であれば、納品後にすぐにお使いいただけるように、工場で製造後に専門スタッフがソフトウェアのインストールを行ってから出荷いたします。また、弊社 HPC 製品だけではなく、他社製のHPC製品へのインストール代行も承っております。OSから科学技術計算用ソフトウェア、ディープラーニング設定、Docker環境構築など、お気軽にお問い合わせください。

ソフトウェア・インストール代行および環境構築一覧

インストール作業名称

・Linux ディープラーニング構築 (NV HPC, NVIDIA Docker, venv環境構築)	・Quantum ESPRESSO (CPU) nvhpc使用
・Linux ディープラーニング構築 (NV HPC, NVIDIA Docker)	・インストール代行
・Windows ディープラーニング構築 (Anaconda-GPU設定あり)	・Quantum ESPRESSO (GPU) nvhpc使用
・FPGA インストール代行	・インストール代行
・COGNEX インストール代行	・Amber インストール代行
・Torque インストール代行	・NV HPC インストール代行
・OpenForm インストール代行	・Relion インストール代行
・インテル コンパイラ (OneAPI 設定)	・Samba インストール代行
・DualBoot インストール代行	・ROS インストール代行
・BricsCAD インストール代行	・TigerVNC インストール代行
・Windowsリカバリー-USB作成	・Webmin インストール代行
・UPS設定(EatonとOmron製)	・IMOD インストール代行
・UPS設定(ネットワーク) (EatonとOmron製)	・GnuPlo インストール代行
・Anaconda設定 (Anacondaのみ)	・Gaussian 16W インストール代行
・R	・Clamav インストール代行 (Ubuntu用ウイルス対策ソフト)
・R インストール代行	・Visual Studio 2022 インストール代行
・Gromacs (GPU動作) インストール代行	・SQLサーバーインストール+ユーザー作成
・Lammps (GPU動作) インストール代行	・SQLサーバーインストール+ユーザー作成+ポート開放
・Quantum ESPRESSO (CPU)	・SQLサーバーインストール+ユーザー作成+ポート開放+SAユーザー認証
・インストール代行	・AMD Optimizing CPU Libraries (AMDのCPUのみ)
・CPUのみの使用GCCコンパイル	・OpenMP インストール代行
	・MATLABインストール※

計算機 (クラスタモデル) パッケージ

設置場所に合わせたクラスタモデル

より大きな計算や複雑な計算になると、一台のワークステーションでは現実的な時間で計算できない場合が生じます。また、より大きな計算や複雑な計算になると動作時のファンの音が気になって近くに置けないこともあります。その時に複数のコンピュータをネットワーク的に結合し、一台のワークステーションとして計算を流すことで、スタンドアロンモデルよりも高速に処理できる場合があります。計算を行う系やご予算に合わせて、各ノードの構成も変えられますので大型ワークステーションを設置する場所がない場合やデスクサイドで行いたい場合にクラスタモデルは最適です。

HPC クラスタ ヘッドノード



CPU :インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ
メモリ :32GB (16GBx2) DDR4-3200
ストレージ :1TB M.2 NVMe-SSD
OS :Ubuntu 22.04 LTS

HPC クラスタ 計算機ノード



CPU :インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ
メモリ :32GB (16GBx2) DDR4-3200
ストレージ :1TB M.2 NVMe-SSD
OS :Ubuntu 22.04 LTS

各種インストール・設定を行った上でお届けいたします



Slurm は、クラスタシステムのためのジョブスケジューラーです。高機能で、拡張性が高く耐障害性があることが特徴です。AI 開発や、ゲノム解析で使用される GPU を含む環境でも有効です。

- 1秒間に最大で 1,000 ジョブ登録、600 ジョブ実行が可能
- REST API が使用可能
- 1 ファイルでのクラスタの管理が可能
- GUI で操作が簡単

クラスタ設定

- ・ OS インストール
- ・ ネットワーク設定
- ・ NFS 設定

ジョブ管理ツールインストール・設定

- ・ Slurm インストール
- ・ 設定ファイル作成

高可用性設定

- ・ Pacemaker インストール
- ・ Corosync インストール

動作検証

On-site Hardware Maintenance Service

オンサイトハードウェア保守サービス

オンサイトハードウェア保守サービスは、弊社にてご購入いただいたワークステーション製品の保守作業を現地で行うサービスです。
通常のセンドバックサービスとは違い、エンジニアがお客様のところに伺って作業を行いますので弊社に製品をお送りいただくことなくハードウェアの修理作業をお受けいただけます。

●オンサイトハードウェア保守サービスの流れ

01  お客様 →  アプライド サポート受付

メールもしくは電話による障害受付

お問い合わせ専用メールアドレス、または専用電話番号まで障害内容をご連絡ください。

※お問い合わせの際には、対象機種種のシリアル番号をご準備ください。

※受付時に受付IDを発行いたします。以降の対応はこのIDにて管理を行いますので、保守作業完了まで大切に保管ください。



02  お客様 ←  アプライド サポート受付

ヒアリング&ログによる障害解析・原因特定

発生した障害に対し、症状・状況の詳しいヒアリングやログのご提供をいただきハードウェアとソフトウェアどちらの問題なのか、問題の切り分けを行います。
ハードウェアの異常個所が特定された場合、原因パーツの交換品手配を行います。

※OSを含むソフトウェアに関する問題やお問い合わせについてはオンサイトハードウェア保守の対象外となります。

※故障パーツの種類によっては、パーツの手配にお時間をいただく場合がございます。

※ヒアリングによる異常個所の特定が難しい場合、通常のセンドバックによる保守対応とさせていただきます場合がございます。



03  お客様 ←  アプライド 技術者

交換用パーツを持ってお客様の元へ

交換用パーツの準備が整い次第、現地対応日程の調整を行ってから現地にお伺いします。
最短で翌営業日以降、保守作業は平日営業時間帯※に行わせていただきます。

※平日営業時間帯 9:00～17:30(土日祝日、年末年始、夏季休暇は除く)



オンサイトハードウェア保守サービス対象地域

日本全国、お客様の所へお伺いし現地に修理対応いたします。
※沖縄県を除く離島は対象外となります。

オンサイトハードウェア保守サービス対象商品

タワー型・ラックマウント型を問わず、アプライドにて製造販売しているワークステーション/サーバー/GPGPUなどのHPC製品で、**本体ご購入時にオンサイトハードウェア保守サービスを契約された製品が対象となります。**

オンサイトハードウェア保守サービス対象外作業

- ・製品導入時の機器運搬・設置や導入後の機器移転に関する作業
- ・これまで使っていた機器の引き取り・廃棄に関する作業
- ・OSを含むソフトウェアに関するお問い合わせ
- ・サービス契約後にお客様により増設されたハードウェアによる異常に関するお問い合わせ
- ・製品の不適切な使用や取り扱いにより生じた故障への対応
- ・天変地異などにより生じた故障への対応
- ・対象製品と同時に購入された物品(モニターや外付けHDDなど)の故障への対応

※保守サービスの詳細は、「アプライドHPC専用オンサイト保守規約」をご確認ください。

保守サービス料金などの
詳細は下記WEBサイトへ



https://bto.applied.ne.jp/onsite_service.html

サーバーラック

各種ラインナップを取り揃えております

サーバーなどの情報通信機器、映像機器などを収納するキャビネットです。
ITインフラ、データセンター、工場などあらゆるIT環境で使用され、
耐震/免震や静音仕様、クーラー搭載などのラックを取り揃えています。

免震/耐震 ラック



●基本性能

主要材質/色/外装処理

材質:スチール
色:ブラック(N-1)レザーステン塗装

規格 耐荷重
19インチ EIA規格 耐震荷重:1000kg

環境対策 屏種類
RoHS指令対応/ グリーン購入法対応 10mm毎

屏種類
HP(ハニカムパンチ 開口率76%)
A(アクリル(色:ブルースモーク))
G(グリーン購入法適合アクリル(色:クリア))

YMR 免震ラック (W700/800) 984,000円～



●基本性能

主要材質/色/外装処理

材質:スチール
色:アイボリー(6Y8.5/0.5)レザーステン塗装

規格 耐荷重
19インチ EIA規格/JIS規格 静荷重:1000kg
耐震荷重:300kg

環境対策 屏種類
RoHS指令対応 10mm毎

屏種類
HP(ハニカムパンチ 開口率76%)

Y4D7 4分割ラック (W700) 725,000円～

サイレント(クーラー)ラック/HPC対応 静音ラック



YCRH(2)サイレントクーラーラック

ハイスペックタイプ

3,547,000円(税込)



YNFH(2)サイレントラック

ハイスペックタイプ

1,020,000円(税込)



YNFMH サイレントハーフラック

ハイスペックタイプ

517,000円(税込)



YNFH サイレントラック (W700)

574,000円(税込)

スタンダードラック



●基本性能

主要材質/色/外装処理

材質:スチール
色:アイボリー(6Y8.5/0.5)レザーステン塗装

規格 耐荷重
19インチ EIA規格/JIS規格 静荷重:1000kg
耐震荷重:300kg

環境対策 屏種類
RoHS指令対応 10mm毎

屏種類
グリーン購入法対応

YER7

144,000円(税込)



YNRKA 顔/ICカード認証セキュリティラック (W600/700/800)

1,495,000円(税込)



YNRF 指紋/ICカード認証セキュリティラック (W600/700/800)

775,000円(税込)



CP-SVC36UN (36U) SOHOや小規模オフィス

294,800円(税込)

アプライド HPC&AI は
商品をじっくり選んで
「見積依頼」もしくは「ご注文」、
「仕様書ダウンロード」が
簡単にできます！

**そのまま
お手軽発注**

「見積依頼」もしくは「ご注文」

アプライド HPC & AI サイト内で興味がある製品のお見積り依頼をしていただく、担当スタッフよりご連絡があり、あなたの PC に本当に必要な機能やスペックを打ち合わせし、最良の 1 台のお見積りを作成します。

**簡単 3 分
お見積り**

仕様書ダウンロード

自分好みに合わせたカスタマイズが可能。項目から選ぶだけで必要な仕様の製品にカスタマイズし、見積もりができます。その見積り内容を仕様書としてダウンロードできます。

各種モデル様々なカスタマイズに対応致します！

アプライド HPC 専用サイト

アプライド HPC 専用サイトにてお客様のご用途に合わせた様々なカスタマイズが可能です。また、WEB サイトより「正式お見積り依頼」と「仕様書のダウンロード」が簡単にできます！

グラフィックボード	基本システム (OS)
	CPU メモリ
3Dグラフィックの描画処理性能で選ぶ (GeForce シリーズ)	ストレージ ビジネスソフト (Office)
OPEN GL に最適化されたソフトを使うなら (RTX A シリーズ)	電源ユニット I/O 拡張ボード
	キーボード/マウス

提供オペレーティングシステム (OS)

アプライドの BTO PC はお客様のご用途に合わせて、ビジネス向けの様々な OS に対応しております。

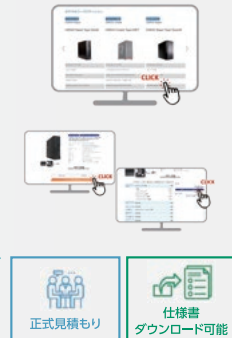
 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC	 Windows 10/11 Pro
 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	 Ubuntu
 Windows Server	

たった 3 分で製品仕様と概算見積もりまで完了！

step 1 様々なタイプから商品を選択
 BTO PC、ワークステーション、HPC サーバーなど様々なタイプのコンピューターからお客様のビジネスに合わせた商品を選択。

step 2 仕様カスタマイズ
 カスタマイズ見積もりのボタンを押していただき、自由にカスタマイズください。お見積り・ご注文へ進むボタンで次に進んでください。

step 3 お見積り依頼・仕様ダウンロード
 選択頂いたカスタマイズの内容にて仕様書をダウンロード頂けます。また、併せて WEB サイトよりお見積り依頼いただけます。



HPC 専用サイト <https://bto.applied.ne.jp/>

HPC / SERVER / AI SERVER **アプライド HPC**



*** APPLIED GROUP**

「AI の日常化に挑戦する会社」

アプライド株式会社 法人営業部

**福岡に HPC 開発部門
生産工場を設置**

msi x APPLIED GROUP

Micro-Star International Co., Ltd. と提携し、日本市場におけるサーバー製品のプレミアムディストリビューター契約を締結

NVIDIA PREFERRED PARTNER

当社はソリューションプロバイダーとして、テクノロジーの専門知識とサービスを組み合わせることで付加価値を高め、お客様の求めるビジネスおよび技術の要件を満たす NVIDIA GPU コンピューティングソリューションを設計、再販、導入までのご提供を開始いたします。

アプライド HPC&AI サイト <https://bto.applied.ne.jp/>

【大学官公庁様 お問い合わせ窓口】

- | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 福岡本部 福岡市博多区上牟田1丁目6-23 | TEL:092-481-7802 | FAX:092-481-7651 | <input type="checkbox"/> 高知営業所 高知市知寄町3-306 | TEL:088-880-5522 | FAX:088-880-5523 |
| <input type="checkbox"/> 北九州営業所 北九州市小倉北区香春口1-7-4 | TEL:093-932-6507 | FAX:093-932-6508 | <input type="checkbox"/> 大阪営業所 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ビル5階 | TEL:06-6838-4123 | FAX:06-6838-4122 |
| <input type="checkbox"/> 熊本営業所 熊本市東区西原3-1-7 | TEL:096-384-5255 | FAX:096-384-5257 | <input type="checkbox"/> 北大阪営業所 高槻市辻子2丁目1-1 | TEL:072-676-9160 | FAX:072-676-9161 |
| <input type="checkbox"/> 大分営業所 大分市願徳町3-3-6 | TEL:097-548-5785 | FAX:097-548-5786 | <input type="checkbox"/> 仙台営業所 仙台市宮城野区新田東3丁目3-5 | TEL:022-782-2737 | FAX:022-782-2738 |
| <input type="checkbox"/> 宮崎営業所 宮崎市橋通西5-6-65 | TEL:0985-23-0008 | FAX:0985-23-0035 | <input type="checkbox"/> 姫路営業所 姫路市安田3-122 | TEL:079-287-0065 | FAX:079-287-0068 |
| <input type="checkbox"/> 鹿児島営業所 鹿児島市上之園町33-2 | TEL:099-214-3918 | FAX:099-214-3919 | <input type="checkbox"/> 京都営業所 京都市右京区西院西清満崎7番地 | TEL:075-325-1025 | FAX:075-325-1026 |
| <input type="checkbox"/> 広島営業所 広島市西区楠木町1-10-1 | TEL:082-235-3536 | FAX:082-235-3537 | <input type="checkbox"/> 北陸営業所 石川郡野々市町字二日市町3-86 | TEL:076-294-1451 | FAX:076-294-1452 |
| <input type="checkbox"/> 福山営業所 福山市南本庄3-4-44 | TEL:084-928-0700 | FAX:084-925-0701 | <input type="checkbox"/> 名古屋本部 名古屋市西区上名古屋3-25-28 第7雑村ビル5階 | TEL:052-325-2783 | FAX:052-325-2791 |
| <input type="checkbox"/> 岡山営業所 岡山市北区鹿田本町7-24 第2シムラビル1階 | TEL:086-235-2703 | FAX:086-235-2705 | <input type="checkbox"/> 静岡営業所 静岡市葵区長沼690 | TEL:054-267-3700 | FAX:054-267-3701 |
| <input type="checkbox"/> 松山営業所 松山市天山3-15-10 | TEL:089-915-2055 | FAX:089-915-2056 | <input type="checkbox"/> 東京営業所 千代田区神田小川町1-11 小川町クロス4階 | TEL:03-5280-9250 | FAX:03-5280-9253 |
| <input type="checkbox"/> 高松営業所 高松市東八世町3-4 | TEL:087-866-7600 | FAX:087-866-8001 | <input type="checkbox"/> 筑波営業所 つくば市宿南前34-13 | TEL:029-860-7808 | FAX:029-860-7809 |

【法人様 お問い合わせ窓口】

- | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 関東営業所 千代田区神田小川町1-11 小川町クロス4階 | TEL:03-5280-9255 | FAX:03-5280-9254 | <input type="checkbox"/> 関西営業所 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ビル5階 | TEL:06-6838-4123 | FAX:06-6838-4122 |
| <input type="checkbox"/> 東海営業所 名古屋市西区上名古屋3-25-28 第7雑村ビル5階 | TEL:052-325-2782 | FAX:052-325-2792 | <input type="checkbox"/> 九州営業所 福岡市博多区上牟田1丁目6-23 | TEL:092-481-7812 | FAX:092-481-7822 |

ご相談無料!

アプライド HPC ご購入前相談窓口

HPC ご購入前相談窓口

☎ 092-481-8050

受付 10:00-17:00

Deep Learning モデルをはじめとした HPC 製品について、お電話または簡単な専用フォームに入力するだけでご相談いただけます。商品詳細、お見積りや導入などご不明な点がございましたらどうぞご相談ください。弊社技術スタッフが徹底サポートいたします。



▲専用メールフォーム